

---

## 業 務

---

### 我們是誰

我們是領先的系統級半導體設計廠商，面向智慧家庭、智慧辦公、智慧出行、娛樂教育、工業生產場景，提供卓越的智能終端控制與連接解決方案，包括智能多媒體與顯示SoC主控芯片、AIoT SoC主控芯片、通信與連接芯片、智能汽車SoC芯片等，致力於賦能全球智能終端從萬物互聯走向萬物智聯。根據弗若斯特沙利文報告，按2024年的相關收入計，我們在專注於智能終端SoC芯片的廠商中位列全球第四（全球市場份額為1.2%），在家庭智能終端SoC芯片領域位列中國大陸第一、全球第二（全球市場份額為17.7%）。

憑藉在高系統複雜性和多維度疊加技術的系統級SoC芯片方面的30年經驗，我們已形成覆蓋神經網絡處理器NPU、視頻編解碼器、音頻解碼器、顯示控制器、內存系統、安全系統、廣域網／局域網網絡接口、輸入輸出子系統等多功能模塊高度全棧自研技術矩陣，可廣泛適配多元智能終端場景需求。我們亦致力於通信與連接芯片的研發，經過10餘年自研IP迭代打磨，在基帶、射頻、協議棧等關鍵領域取得重大進展，我們的自研無線通訊Wi-Fi芯片和LTE芯片可高度適配我們的SoC芯片，滿足更多元的AIoT場景需求。

隨著基礎模型與生成式AI的持續演變，智能終端設備的功能與邊界都在被重構，我們憑藉深厚技術，以及與全球頭部運營商、電視生態廠商、智能終端設備廠商的深度合作，深刻理解市場需求與產品方向，前瞻性佈局端側AI芯片在消費類電子、智慧城市、機器人、汽車等領域的應用以及通訊與連接芯片在低延時高性能物聯網的應用等方向，持續擴大技術與產品的覆蓋維度及行業影響。

我們在全球範圍深耕智慧家庭生活這一廣闊賽道，瞄準大市場，把握增長機會，確立領先地位。截至2025年12月31日，我們的芯片累計出貨量超10億顆。根據弗若斯特沙利文提供的資料，2024年，全球每3台智能機頂盒即搭載一顆我們的智能機頂盒芯片、每5台智能電視即搭載一顆我們的智能電視芯片。我們的業務遍佈全球，覆蓋全球主流運營商270餘家、全球領先的電視品牌（如海信、TCL及創維）以及眾多AIoT廠商及汽車廠商，已整合至超過100個國家和地區的家庭屏幕中。

---

## 業 務

---

### 我們的變革性市場機遇

隨著4G、5G和6G實現萬物互聯，AI算法注入萬物「思考能力」，邊緣計算讓人工智能下沉至場景末梢，以及產業數字化轉型的深入與消費端對智慧生活的需求，萬物智聯的時代浪潮已至。智能終端設備正以百億級規模構建起智能化時代的底層基礎設施，而SoC解決方案則為支撐這些設備互聯互通、賦能增效的數字化轉型提供核心支撐。在這一浪潮中，消費電子領域迎來了爆發式創新與增長機遇。

**智慧家庭應用：**不斷發展的家庭網絡基礎設施與流媒體內容、物聯網+AI技術的普及與消費者對更智能體驗需求的持續提升，共同推動全球智能家居SoC產品市場快速增長。根據弗若斯特沙利文報告，全球家庭智能終端SoC市場將從2024年的38億美元大幅增長至2029年的77億美元，複合年增長率達到15.2%。其中，預期智能家庭AISoC市場將從2024年的5億美元大幅增長至2029年的60億美元，複合年增長率高達64.4%。

**商業及教育應用：**受益於對智能化客戶體驗的需求及企業數字化轉型，商業及教育智能終端SoC市場將有望持續保持高速增長。根據弗若斯特沙利文報告，全球商業及教育智能終端AI SoC市場將從2024年的6億美元增長至2029年的47億美元，複合年增長率達到50.9%。

**智能汽車應用：**消費者對智能功能的需求急劇增長，促使汽車製造商通過先進智能系統打造差異化優勢。消費者對車載系統沉浸式體驗的持續追求、汽車行業向電動化和智能化演進及AI應用迅速發展等多方面共同驅動智能汽車SoC市場將迎來增長機遇。根據弗若斯特沙利文報告，全球智能汽車SoC市場將由2024年的113億美元增長至2029年的392億美元，複合年增長率將達到28.2%。預期智能座艙及信息娛樂SoC市場將由2024年的42億美元增長至2029年的143億美元，複合年增長率達到27.6%。

**通信與連接芯片應用：**隨著智能物聯網擴展，數據密集度提升，以及家庭需求增長，具備穩定、低功耗及大規模接入能力的通信與連接芯片解決方案，成為核心需求。根據弗若斯特沙利文報告，全球Wi-Fi芯片市場規模將由2024年的189億美元增長至2029年的281億美元，複合年增長率達到8.3%。

---

## 業 務

---

### 我們的多元化產品和解決方案

我們的芯片設計能力整合先進制程工藝，實現成本、性能和功耗的極致優化。我們的智能設備SoC解決方案依託多種開放平台構建，支持廣泛的應用場景。我們的產品主要包括智能多媒體與顯示SoC主控芯片、AIoT SoC主控芯片、通信與連接芯片、智能汽車SoC主控芯片等，幫助全球運營商、AIoT設備廠商、汽車廠商等實現產品升級與數智生態建設。

### 智能多媒體與顯示SoC

我們在過去30年的發展歷程中，始終圍繞家庭娛樂智能化發展趨勢，在每次重大技術轉型均勇立市場潮頭，搶灘藍海市場。我們的智能多媒體與顯示SoC芯片已廣泛應用於智能機頂盒、智能電視、智能投影儀、顯示器及其他商用顯示終端。

我們應用於智能機頂盒的SoC芯片包括全高清系列芯片、4K超高清系列芯片和8K超高清系列芯片，已廣泛應用於IPTV機頂盒、OTT機頂盒、混合模式機頂盒。我們的SoC芯片利用先進的芯片制程及自研NPU，可支持AI遊戲、AI卡拉OK、AI實時翻譯、AI廣告植入、AI畫質和內容增強等先進AI功能。我們的芯片方案已被國內三大運營商以及北美、歐洲、拉丁美洲、亞太和非洲等眾多海外頭部運營商應用。

對於智能電視和智能投影儀，我們主要提供全高清和超高清SoCs，最高支持4K視頻解碼，支持全球超過100個國家和地區的數字電視廣播標準。我們的解決方案已被知名電視及顯示設備廠商廣泛應用，覆蓋全球品牌（如海信、TCL、創維及小米），並進一步拓展至下一代遊戲及辦公室顯示器等相關智能設備領域。

截至最後實際可行日期，我們已推出顯示器SoC。有關顯示器SoC支持QHD分辨率及300Hz刷新率輸出，專為遊戲、辦公、專業設計顯示器及商用顯示設備設計。

### AIoT SoC芯片

我們提供面向智能家電、服務及工業機器人、智能健身設備、AR娛樂終端、智慧教育平板與智能會議系統等廣泛AIoT應用場景量身定制的先進SoC解決方案。我們的SoCs突出搭載自研NPU知識產權的端側AI技術，在聲音、圖像和算力方面賦予設備卓越的本地化識別、分析與處理能力。

---

## 業 務

---

在端側音視頻技術領域，我們致力於實現直接在設備上進行智能感知與互動。我們採用支持遠場語音拾取算法的高性能多核CPU及DSP，並透過專用音頻信號處理技術，提供設備端高品質降噪、音頻增強及多聲道音頻協同。有關能力結合內建的端側機器學習能力，可在設備端高效執行智能感知任務。

我們的自研架構與經優化的系統設計兼容主流AI框架，在嚴格的功耗與時延限制下仍可實現高推理性能，為多樣化的AIoT場景提供可擴展、高能效的計算平台。依託AI大語言模型的快速發展，我們正深化與主流大語言模型生態合作夥伴的合作，為端側用戶界面應用開發更高算力的AI SoCs及一站式解決方案，藉此滿足對雲端協同日益增長的需求。

### 通信與連接芯片

憑藉在互聯網多媒體的戰略佈局，我們致力於研發與我們的SoCs高度適配的通信與連接芯片，提供全面的產品解決方案。我們經過持續的自主研發，在基帶、射頻、協議棧技術等方面取得重大突破，並已圍繞企業與家庭應用場景構建三大產品類別，分別為Wi-Fi芯片、光纖芯片及蜂窩芯片。

### 智能汽車SoC芯片

伴隨著乘用車智能化浪潮，我們將強大技術優勢複製到了智能出行領域。我們自主研發了符合車規級標準的車載信息娛樂系統SoC和智能座艙SoC，具有高集成度、高性能和低功耗等特點，內置高算力神經網絡處理器，支持多系統多屏幕顯示。

### 我們的先進技術實力和卓越生態佈局

我們是SoC芯片的先驅，自1995年進入SoC芯片設計領域，經過三十年的持續研發投入及與客戶長久的產品驗證，在智能終端SoC領域構築起壁壘極高的技術和生態護城河。

我們是業內最早獨立自主研發智能終端SoC芯片全鏈路技術的廠商之一，我們在芯片設計、IP、軟件和系統四大領域全方位構築了領先的技術實力。我們設計的產品覆蓋28nm至6nm的制程工藝，通過高集成度與超低功耗架構設計，實現了性能與能效

---

## 業 務

---

的極致平衡。我們的IP技術集群涵蓋音視頻編解碼、圖像處理、神經網絡、AI加速、安全、ISP、通信連接、多種高速外圍接口等關鍵模塊，均可定制化開發以滿足客戶的特定需求。

我們構建了廣泛的操作系統適配能力，優化支持多個平台；確保全面支持各類標準與開源社區以及全球化生態認證與本地化。我們的研發團隊具備端到端系統級解決方案整合能力，使包括硬件和軟件在內的所有組件作為一個統一的系統無縫運行，從芯片硬件到軟件棧，實現「芯片－系統－場景」全鏈路協同優化。截至2025年12月31日，我們在中國及海外擁有373項授權專利，並圍繞上述技術與專利，採用先進的技術製造工藝，開發了智能多媒體與顯示SoC主控芯片、AIoT SoC主控芯片、通信與連接芯片、智能汽車SoC芯片等廣泛覆蓋各品類智能終端的高集成度、高性能、低功耗產品。

我們系國際Wi-Fi聯盟組織、藍牙技術聯盟、國際連接標準聯盟(Connectivity Standards Alliance)、國際HDMI論壇(HDMI Forum)、視頻電子標準協會(VESA)、世界超高清聯盟及其他行業組織(包括汽車電子產業聯盟、中國RISC-V產業聯盟)的成員。

我們深度綁定全球各細分領域頭部客戶。我們的解決方案已深度融入全球主流運營商生態，得到其長期可靠性驗證，構築了極高的進入壁壘，我們積極抓住運營商的IP化轉型所帶來的機遇，順勢推廣我們的產品應用。

### 競爭優勢

#### 強大的系統級 SoC 創新能力

我們是一家領先的系統級半導體設計廠商，在智能機頂盒、智能電視及智能家居等終端領域均處於市場領先地位，2025年累計芯片出貨量超過1.7億顆。根據弗若斯特沙利文的報告，以2024年銷售金額計算，在智能機頂盒SoC領域，我們是全球第一廠商(全球市場份額為31.5%)；在智能電視SoC領域，我們是全球第二、中國大陸第一大廠商(全球市場份額為16.8%)。

智能多媒體與顯示SoC領域，我們率先引入先進制程工藝及自研端側AI NPU模塊，先後推出全球首款8K超高清、集成inline AI-SR和3.2 Tops通用NPU智能機頂盒SoC S928X，獲得國內運營商的高度認可。儘管市場上大多數競爭對手仍專注於4K SoC解決方案，但S928X對原生8K解碼及AI-SR處理的支持，使我們在下一代UHD多媒體SoC領域具備了競爭優勢。

## 業 務

全球首款採用6nm制程、搭載NPU AI-SR和4Tops通用NPU的智能機頂盒SoC S905X5，自2024年下半年開始大規模商用。我們採用6nm制程技術，表明機頂盒SoC製造領域實現了重大突破，因為業內大多數廠商仍在使用11nm至28nm的制程節點。總體而言，我們的6納米芯片於2025年的銷售量接近九百萬顆，進一步證實了我們6納米製程技術的成熟度與商業化規模。

2017年我們推出全球首款12nm 4K超高清智能顯示終端SoC芯片T972。根據弗若斯特沙利文的資料，我們2025年推出的新款智能多媒體與顯示SoC，T966D5，可實現原生4K分辨率下達到165Hz的刷新率，這是當前業內4K顯示SoC所能達到的最先進刷新率水平。搭載第13代TruLife專業版圖像引擎，配合運動估計和運動補償MEMC模塊，能將低刷新率視頻智能提升至最高144Hz；其自研的人工智能超分辨率AI-SR算法模塊，可智能化提升圖像分辨率，為客戶呈現栩栩如生的視覺效果，性能持續領跑全球。

AIoT SoC領域，我們高性能智能家居類芯片A311D2實現了超低延遲智能人體姿態識別解決方案，且是業內首批集成自研NPU的芯片之一；此外，我們智能影像SoC C302X配備智能ISP技術，能夠實現在低光環境中提供清晰的實時圖像。

通信與連接芯片領域，我們自主研發的三模無線連接SoC芯片創新性地將WIFI 6 2\*2、BT 5.4及IEEE 802.15.4集成到單顆芯片中，得到客戶的充分認可。WIFI 6系列產品2025年增長強勁，進入快速放量階段。我們的連接芯片採用與主控SoC協同進行系統級聯合優化的設計，通過降低通信延遲、提升數據傳輸穩定性，相比同類產品具備顯著技術優勢。這種集成架構可確保其在智能家居系統及多媒體應用場景中均能實現最佳性能。

根據弗若斯特沙利文的資料，汽車及相關領域，我們的連線智能座艙芯片V901D是業內首批獲得車規級認證的汽車智能座艙SoC之一。我們的V901D對安卓系統的兼容性得到顯著提升，能夠在下一代智能座艙應用中實現更出色的性能、穩定性與用戶體驗。

### 豐富的自研IP資源庫，打造可擴展平台化生態體系

我們深耕SoC芯片設計三十餘年，堅持關鍵核心技術自主可控，圍繞神經網絡、ISP、音視頻編解碼等數據處理模塊，USB、HDMI、DDR、PCI-e等高速外圍接口模塊，以太網、WiFi、藍牙、4G/5G、PON等網絡互聯模塊，高速SerDes、ADC等核心功能模塊，持續投入研發力量構建高可複用的通用IP資源庫，目前我們的SoC芯片中自研功能模塊比例超過70%。

---

## 業 務

---

我們於2010年完成開發第一代畫質處理IP，已歷經了13代演進。深厚的技術積澱使得我們能夠將自研IP模塊廣泛複用於不同系列芯片中，形成「技術共享－快速複製－應用拓展」的研發範式。

我們為OEM提供基於多個操作系統的量產級別解決方案和成熟的參考設計。我們的數據安全方案包括芯片級硬件防護、後量子密碼安全啟動技術（使用為抵禦量子計算機攻擊而設計的高級加密算法，確保僅執行受信任的軟件）和基於TrustZone技術的安全操作系統及通過認證的DRM解決方案。我們根據客戶需求定制化提供軟硬件融合的全套生態解決方案，從而與客戶深度綁定。

自研IP資源庫可以根據具體場景的需要靈活組合複用，提升了研發效率和產品迭代速度，使我們能夠推出與市場需求高度契合的產品，縮短產品上市週期，增加產品生命週期收益，最終形成穩定的收入來源並持續貢獻長期利潤。

### 開創端側AI技術與新一代制程技術

我們採用前瞻性佈局，通過自主研發及整合NPU等核心模塊，發展端側AI算力技術。截至最後實際可行日期，有20款量產芯片集成自研端側AI算力單元。於2025年，該等芯片出貨量突破20.0百萬顆，與2024年相比，增長160%。我們的端側AI芯片可在設備端實現同聲翻譯、語音識別、手勢識別、體態識別、語音增強、圖像增強等功能，滿足低延遲、高隱私保護的智能終端需求。

2024年推出基於6nm先進制程的S905X5 SoC芯片，集成ARM V9架構和先進的端側AI算力。基於12nm制程並具有8K超高清能力的S928X芯片亦成功進入全球高端市場。我們預期日後將有多款基於6nm先進制程的芯片進入量產。

我們仍深耕端側AI及先進制程，引領產品開發及行業標準，並不斷向智能機器人、集成智能汽車及座艙交互系統等新技術領域佈局。端側AI技術將推動我們的產品在高端消費電子和汽車電子等領域的快速滲透，帶來更高單價與更多市場機遇。

---

## 業 務

---

### 與全球行業領導者及生態系統平台構建長期戰略合作關係

我們已與全球頂尖品牌及主流生態系統平台建立起穩固且長期的戰略合作關係。借助與其的深度融合，我們在客戶信任、認證週期、定制開發等層面形成競爭優勢，能夠以更短的時間及更低的邊際成本推出新產品。於往績記錄期間，我們的智能多媒體及顯示SoC芯片獲得中國內地三大運營商的大額訂單，並成功進入北美、歐洲、拉丁美洲、亞太及非洲地區主流運營商的供應鏈體系。截至最後實際可行日期，我們的解決方案接入超過270家大型電信運營商的供應網絡。S905X5、S928X等高端芯片產品在多家國際運營商的招標項目中脫穎而出。

我們通過與國際主流電視及智能設備生態系統的深度技術合作，成功完成全球技術對接和認證。截至2025年12月31日，產品已覆蓋全球領先的電視品牌（如海信、TCL及創維）。借助這些生態平台，我們的產品迅速實現全球落地與規模出貨。憑藉在主流生態中建立起的先發優勢，我們與頭部客戶深度綁定，共同完成產品定義與研發，形成了深厚的生態壁壘。例如，我們依託與某北美智能電視頭部品牌的戰略合作，成功將業務版圖從拓展至該品牌的智能音箱、智能網絡攝像頭等多重產品系列。

### 具備敏捷的全球運營與強大的本地化響應能力

我們自成立以來即堅持全球化佈局戰略，構建覆蓋北美、歐洲、東南亞等主要市場的研發、銷售與服務網絡。針對不同地區的政策、運營商標準、語言環境與終端接口規範，構建起高效的產品適配與認證流程。

我們的產品銷售覆蓋中國內地、香港、北美、歐洲、拉丁美洲、亞太、非洲等全球主要經濟體，客戶類型涵蓋國際電信運營商、智能終端品牌商、OEM/ODM廠商等。我們的全球化業務佈局有效地分散了單一市場的宏觀環境波動與政策變動帶來的不確定性，為我們帶來更穩定的收入來源。

### 經驗豐富的管理及研發團隊

本公司由一支穩定、富有遠見且經驗豐富的管理團隊領導。我們的核心團隊由資深專家組成，成員在半導體行業平均擁有超過20年的從業經驗。我們的核心管理及技術團隊成員大多擁有國際化的教育背景和在全球知名科技企業工作經歷。我們持續投資我們的研發團隊及研發活動，即使在行業週期性波動期間，我們也未曾放緩追

## 業 務

求技術進步的腳步。於往績記錄期間，我們的研發開支連續增長，累計達合共人民幣4,187.2百萬元，佔往績記錄期間各年營收比重超過20%，持續位居中國集成電路設計行業前列。截至2025年12月31日，本公司擁有研發人員1,684名，佔員工總數比例超過87%，同樣處於中國集成電路設計行業領先水平。高強度的研發投入及研發人員在員工隊伍中的高佔比，彰顯了我們對創新的堅定承諾，也為公司在行業內持續保持技術領先地位奠定堅實基礎。

## 戰略

### 持續端側AI及通訊與連接技術研發創新，深化智能終端場景佈局

我們將堅持「瞄準大市場、確定性機會、高質量創新」的研發原則，在智能設備領域，我們積極發掘重大的商機，並提供及時的產品解決方案。具體而言：我們計劃(i)推進智能終端先進制程SoC產品迭代研發，重點推進基於6nm及更先進制程的芯片升級；(ii)持續投入IP自研，進一步強化芯片集成度，實現性能持續提升；(iii)深入研發端側AI技術研究，密切跟進大語言、多模態模型在新興AIoT應用，完善解決方案場景覆蓋；(iv)深化機器視覺技術應用，打造為機器人與先進端側視覺處理定制的高性能視覺解決方案，並密切關注生成式AI在視覺領域的應用，保證我們的發展既具創新性又切合實際需求；及(v)延伸通信與連接技術應用，研發下一代無線連接芯片，擴展在蜂窩通信上的技術能力，並同步在有線通訊領域佈局光通信芯片，構建以軟硬件層面的「端側智能+算力+通信」為支撐的「蜂窩通信+光通信+Wi-Fi技術與產品」的全面生態系統。

### 深耕頭部客戶生態合作，延伸智能終端市場需求

我們將加速在智能機頂盒、智能電視、智能家居等優勢智能終端領域的市場滲透。根據弗若斯特沙利文提供的資料，全球每年智能機頂盒市場銷量約為1.5億台、每年電視市場銷量約為2.0億台。我們將憑藉技術優勢、市場地位優勢及客戶關係，持續提升我們在上述的市場份額。

---

## 業 務

---

我們致力於研發集成端側AI與先進連接功能的SoC解決方案，旨在實現卓越性能，並提升我們產品的單位價值。隨著市場份額與出貨量增長，我們預期將受益於規模經濟，從而降低邊際成本及提高議價能力。我們已與全球電信營運商、頂尖顯示器製造商、主要流媒體平台、標準制定機構及頂級OEM建立穩固的合作夥伴關係。

我們緊跟客戶的產品開發方向及生態拓展方向：(i)提前佈局下一代AIoT應用領域；(ii)把握運營商IP化和AI化轉型推動智能家居、智能辦公、工業物聯網等市場快速的產業機遇，通過開發先進無線連接技術，並借助運營商網絡順勢推廣；及(iii)把握汽車智能化全面普及浪潮，提升國內市場份額。

### 以強大的人才庫推動產品創新

人才是我們持續保持技術領先及長期發展的關鍵支撐。我們致力於持續引進高水平的研發人才，重點招募自主IP開發、端到端創新以及通信與連接和端側AI芯片設計等專業能力，以強化我們的核心芯片設計能力，尤其在自主IP及系統架構優化能力，並加強通信與連接及端側AI領域的技術專長。

### 探索戰略投資併購機會，鞏固技術領先

我們將通過戰略投資及收購進一步完善我們的技術生態系統，重點識別全球範圍內的商機，特別是符合以下標準的項目：(i)在通訊與連接領域(包括4G/5G、光纖及GPS)擁有核心IP或關鍵技術的企業，補充並加速自身技術進程；(ii)其產品線可強化我們產品解決方案的企業，提供更全面、完善的服務方案；及(iii)在工業／服務機器人及能動型AI領域具備成熟客戶渠道及資質的專注於AIoT芯片的企業，借助其資源快速切入市場。我們將通過投資及收購，融合互補的技術能力、知識產權、產品方案、供應鏈體系及客戶基礎，進一步強化「平台+生態」模式下的競爭力。

### 我們的業務模式

我們是無晶圓半導體公司，專注於智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC、通信與連接芯片以及智能汽車SoC。我們委聘第三方供應商進行製造、測試、封裝、分銷以及部分研發。憑藉豐富行業經驗及我們的高可複用通用IP資源庫。我們已與多個領域的頭部客戶建立穩固的合作關係。我們的業務足跡遍佈全球，涵蓋中國內地、香港、

## 業 務

北美、歐洲、拉丁美洲、亞太及非洲。我們採取直銷及分銷兩種模式。於往績記錄期間，我們向全球電信運營商、領先的電視品牌商（如小米、創維、TCL、海信、海爾及希沃）以及廣泛AIoT品牌提供SoC。

### 我們的產品

下表載列我們於往績記錄期間按業務線劃分的收入。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	<i>(人民幣千元，百分比除外)</i>					
<b>銷售芯片</b>						
智能多媒體及						
顯示SoC.....	4,060,358	75.6	4,290,644	72.4	4,948,755	72.9
AIoT SoC.....	1,200,376	22.3	1,511,255	25.5	1,639,661	24.2
通信與連接芯片.....	77,111	1.4	119,579	2.0	199,797	2.9
智能汽車SoC及						
其他芯片.....	32,039	0.7	4,837	0.1	1,419	-
提供技術服務 <sup>(1)</sup> .....	1,058	0.0	-	-	950	-
<b>總計</b> .....	<b>5,370,942</b>	<b>100.0</b>	<b>5,926,315</b>	<b>100.0</b>	<b>6,790,582</b>	<b>100.0</b>

附註：

(1) 提供技術服務的收入主要與2021年承接的一位客戶的定制化項目的安裝付款有關。

我們的SoC集成CPU、GPU、NPU、視頻編碼器及解碼器、音頻解碼器、顯示控制器、存儲系統、網絡接口以及輸入／輸出子系統等其他多功能模塊。此等程度的集成使得處理器芯片可執行核心功能，包括計算、圖像及視覺處理，以及音視頻編碼與解碼，作為向其他系統組件發出指令的主要控制中心。我們的SoC已廣泛應用於一系列領域，包括智能家居、商業、工業、移動設備、娛樂、教育、遊戲系統、體育、健身和農業。我們的SoC提供必要的計算及控制能力。下圖展示我們SoC產品線的下游應用。



## 業 務

業務線	產品類型	終端應用	行業板塊
	顯示器SoC	遊戲和顯示應用	
AIoT SoC . . . . .	端側AI計算SoC	數字標牌；視頻會議系統；智能商用顯示器；AI教育平板；遊戲系統；智能健身設備；智能服務機器人	智能家居；商業及教育；個人移動設備
	端側AI視覺SoC	智能門禁；考勤機；狩獵相機與運動相機；智能可視門鈴；智能美妝鏡；人臉支付設備	
	端側AI音頻SoC	智能音箱；條形音箱(soundbar)；音頻流媒體播放器／放大器；電視音頻DSP；語音網關設備；智能音箱燈；智能語音助手	
通信與連接芯片 . . . . .	Wi-Fi芯片	智能家庭終端；IoT網關；流媒體設備；智能音頻／視頻設備	各類智能設備及網絡設備
	光纖芯片 <sup>(1)</sup>	光纖路由器；FTTR主網關	
	蜂窩芯片	智能穿戴設備；智能玩具	
智能汽車SoC及其他芯片 . . . . .	信息娛樂系統SoC	智能汽車主控制器；車載顯示器	智能汽車及其他
	智能座艙SoC	智能汽車主控制器；車載顯示器	

附註：

(1) 截至2025年12月31日，我們已完成FTTR網關芯片的流片階段。

---

## 業 務

---

### 智能多媒體及顯示SoC

#### 智能機頂盒SoC

我們於2012年首次推出智能機頂盒SoC，且於2018年已成為中國所有全球智能機頂盒SoC供應商中領先的提供商（按收入計）。智能機頂盒是集成了傳統廣播內容、OTT內容傳輸、遊戲、本地媒體播放及互聯網應用等功能的多功能設備。我們的智能機頂盒SoC充當核心處理器，將原始的數字廣播信號轉換為清晰且穩定的視聽輸出信號。我們的智能機頂盒芯片主要包括FHD、4K UHD和8K UHD芯片，主要用於IPTV、OTT及混合型機頂盒。根據弗若斯特沙利文提供的資料，於2024年至2029年，IPTV和OTT機頂盒的出貨量預計將以7.0%的複合年增長率增長。我們是全球首家為IPTV機頂盒推出SoC的公司。

## 業務

下表載列智能機頂盒SoC的主要產品類型。

產品類別	產品圖片	主要特徵	應用
8K 4K		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：12-nm</li> <li>CPU：單一Cortex-A76及四核Cortex-A55</li> <li>GPU：Mali-G57 MC2，支持4K分辨率用戶界面</li> <li>NPU：3.2 TOPS搭載AI-SR</li> <li>解碼：8Kp60</li> </ul>	<p>面向高端市場，集成了專有的AI功能，除提供高達8K UHD的逼真圖像外，還支持多種智能任務。其廣泛應用於：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>智能UHD OTT/IPTV 機頂盒</li> <li>智能電視棒</li> <li>智能投影儀</li> <li>AR 終端倉儲機器人</li> <li>流媒體播放器</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：6-nm</li> <li>CPU：四核ARM v9 Cortex-A510</li> <li>GPU：Mali-G310 V5，支持4K分辨率用戶界面</li> <li>NPU：Generic 4 TOPS NPU及AI-SR專用NPU</li> <li>解碼：4Kp120</li> </ul>	
4K 高端		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：6-nm</li> <li>CPU：四核Cortex-A55</li> <li>GPU：Mali-G310 V2，支持HDR用戶界面</li> <li>NPU：AI SR專用NPU</li> <li>解碼：4Kp75 UHD</li> </ul>	<p>面向高端及主流市場，支持4K視頻流暢播放、輕量級應用程序高效運行，及持續低功耗，兼具高性能。其廣泛應用於：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>智能UHD OTT/IPTV 機頂盒</li> <li>智能投影儀</li> <li>智能健身設備</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：11-nm</li> <li>CPU：四核Cortex-A55</li> <li>GPU：Mali-G31 MP2</li> <li>解碼：4Kp75 UHD</li> </ul>	
4K 主流		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：11-nm</li> <li>CPU：四核Cortex-A55</li> <li>GPU：Mali-G31 MP2</li> <li>解碼：1080p75</li> </ul>	<p>主要面向入門級機頂盒市場設計，以超高性能比提供高清晰度。其廣泛應用於：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>智能FHD OTT/IPTV 機頂盒</li> </ul>

---

## 業 務

---

根據弗若斯特沙利文提供的資料，於2024年，我們在全球率先推出基於最新ARMV9架構的6-nm機頂盒SoC。我們專有的邊緣智能技術將先進的AI與機器學習直接融入芯片，使得可在本地設備上執行實時字幕生成及語言翻譯等任務，消除雲處理所帶來的延遲，同時催生新一代AI廣告技術。我們的8K智能機頂盒SoC在國內電信運營商的招標中獲得較高的客戶認可度，且我們已取得國際領先電信運營商的訂單。

我們的智能機頂盒SoC能夠滿足流媒體提供商、OEM以及電信運營商。我們的SoC已獲得主要流媒體提供商的認證，且已獲得全球領先條件接收系統提供商的認可。我們的智能機頂盒SoC獲知名製造商（包括創維及小米）廣泛採納，且我們SoC所驅動的設備已被中國、北美洲、歐洲、拉丁美洲、亞太地區及非洲領先的運營商合作夥伴廣泛應用。

### **智能顯示終端SoC**

我們的智能顯示終端SoC是智能電視及其他顯示設備的核心處理器，使電視能夠接收數字信號，將其解碼，並將內容進行處理以提升質量。根據弗若斯特沙利文提供的資料，全球智能電視出貨量預計將從2024年的206.1百萬台增長至2029年的248.3百萬台，複合年增長率為3.8%。我們於全球所有智能電視SoC提供商中排名第二，市場份額為16.8%（按2024年的收入計）。

我們的智能顯示終端SoC搭載高性能32位或64位多核CPU，並配備3D GPU。該SoC提供支持高達4K分辨率以及10位色彩深度的視頻解碼，支持AV1、H.265、VP9及AVS3/AVS2等所有主流視頻標準，同時完全兼容Dolby Vision、HDR10和HLG等HDR格式。我們自研的TruLife畫質增強引擎為提升視覺質量已集成視覺NPU。

## 業務

下表載列我們智能顯示終端SoC的主要產品類別。

產品類別	產品圖片	主要特徵	應用
4K 高端HFR AI 4K 主流HFR		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：12-nm</li> <li>CPU：雙核 Cortex-A76+ 雙核 Cortex-A55</li> <li>GPU：Mali-G57 MC2，支持 4K UI</li> <li>NPU：3.2Tops 搭載 AI-SR</li> <li>PQ 引擎：第 12 代 Trulife 高端畫質增強引擎 (搭載 MEMC)</li> <li>刷新率：4K 144 Hz</li> <li>解碼器：4Kp120</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4K UHD 智能一體電視</li> <li>智能 UHD 投影儀</li> <li>UHD 遊戲顯示器</li> <li>智能商用顯示器</li> <li>智能會議屏</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：12-nm</li> <li>CPU：Penta Cortex-A55</li> <li>GPU：Mali-G52 MC1</li> <li>NPU：AI SR 專用 NPU</li> <li>PQ 引擎：第 13 代 Trulife 高端畫質增強引擎 (搭載 MEMC)</li> <li>刷新率：4K 144/165 Hz</li> <li>解碼器：4Kp75</li> </ul>	
4K 主流		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：11-nm</li> <li>CPU：Penta Cortex-A55</li> <li>GPU：Mali-G31 MP2</li> <li>NPU：AI SR 專用 NPU</li> <li>PQ 引擎：第 13 代 Trulife 畫質增強引擎 (搭載 MEMC)</li> <li>解碼：4Kp75</li> </ul>	<p>為主流市場設計，具有高性能、低功耗與超高性價比，支持 4K UHD，高保真及流暢的視聽體驗。其廣泛應用於：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>智能電視</li> </ul>
2K		<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：11-nm</li> <li>CPU：四核 Cortex-A53</li> <li>GPU：Mali-G31 MP2</li> <li>PQ 引擎：第 13 代 Trulife 畫質增強引擎</li> <li>解碼：4Kp75 UHD</li> </ul>	<p>為入門級市場設計，聚焦極致性價比，提供 HD 且流暢的視聽體驗。其廣泛應用於：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>智能電視</li> </ul>

---

## 業 務

---

我們的智能顯示終端SoC已獲小米、海爾電視、TCL、創維、海信、長虹及希沃等領先的電視及智能終端品牌商採用，且我們已與主要的全球電視生態系統合作夥伴建立深入合作。

### **顯示器SoC**







截至最後實際可行日期，我們已推出顯示器SoC。顯示器SoC支持QHD分辨率及最高300Hz刷新率輸出，可適配多種分辨率輸入，專為遊戲、辦公、專業設計顯示器，以及數字標牌、廣告顯示屏、拼接屏等商用顯示設備設計。

### **AIoT SoC**

我們的AIoT SoC管理接收、解碼和處理音頻及視頻信號等核心功能，憑藉先進的遠場語音和降噪技術，支持UHD解碼和AI驅動的畫質增強。通過整合多模態處理，我們的AIoT SoC無縫融合視覺和音頻信息，並透過AI驅動決策提供支持，賦能智能音箱、交互式顯示屏和家庭安防系統等設備。我們將一系列先進的處理器（包括NPU、DSP、視覺處理單元、ISP及編解碼器），集成至單一的SoC，並搭配用於面部識別、手勢識別、目標檢測、語音識別、動態圖像處理及大語言模型處理的AI算法。

## 業務

下表載列AIoT SoC的主要產品類別。

產品類別	產品圖片	主要特徵	應用
 端側AI計算	 A311D2	<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：12-nm</li> <li>CPU：四核Cortex-A73+四核Cortex-A53</li> <li>GPU：Mali-G52 MC4. 4K UI</li> <li>NPU：高達5 Tops</li> <li>解碼：4Kp75</li> </ul>	以端側AI計算性能為特點，同時支持多個AI任務。其廣泛應用於： <ul style="list-style-type: none"> <li>數字標牌</li> <li>視頻會議系統</li> <li>智能商用顯示器</li> <li>AI教育平板</li> <li>遊戲系統</li> <li>智能健身設備</li> <li>智能服務機器人</li> <li>其他智能家居電</li> </ul>
	 C308X	<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：12-nm</li> <li>CPU：雙核Cortex-A55</li> <li>NPU：4 TOPS, 8M pixel ISP</li> <li>ISP：8M pixel HDR ISP</li> <li>編碼：4Kp30</li> </ul>	可為IP攝像頭和電池攝像頭實現複雜的端側視覺處理和始終開啟的視頻(AOV)應用，具有超高性能及超低功耗。其廣泛應用於： <ul style="list-style-type: none"> <li>智能門禁</li> <li>考勤機</li> <li>狩獵相機與運動相機</li> <li>智能可視門鈴</li> <li>智能美妝鏡</li> <li>人臉支付設備</li> </ul>
 C302X	 A113X2	<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：12-nm</li> <li>CPU：雙核Dual-A35</li> <li>NPU：1 TOPS+CVE</li> <li>ISP：5M pixel HDR ISP，針對弱光環境優化</li> <li>編碼：5M30</li> </ul>	以多通道集成電路問音頻接口 (inter-IC sound interface) 為特點，配備360度全向高靈敏度麥克風陣列，可從任意方向實現喚醒功能，非常適合智能音頻設備。其廣泛應用於： <ul style="list-style-type: none"> <li>智能音箱</li> <li>條形音箱(Soundbar)</li> <li>音頻流媒體播放器/放大器</li> <li>電視音頻DSP</li> <li>語音網關設備</li> <li>智能音箱燈</li> <li>智能語音助手</li> </ul>
	 A113L2	<ul style="list-style-type: none"> <li>工藝：12-nm</li> <li>CPU：四核A53</li> <li>解碼器：Dolby ATMOS/DTS:X</li> </ul>	

## 業 務

我們的AIoT SoC獲得了谷歌企業設備授權協議(EDLA)體系的認證，表明我們的產品在大尺寸商用設備中的兼容性和性能。我們的產品已被集成至眾多知名企業的終端產品中，包括小米、Maxhub、TCL及三星。

### 通信與連接芯片

經過十多年的自主研發和對外整合，我們已建立覆蓋WAN和LAN，有線和無線通信，以及遠距離和短距離傳輸的全面技術與產品組合。我們的通信與連接芯片與SoC產品完全兼容。

#### Wi-Fi芯片

我們的站點模式Wi-Fi芯片可實現穩定的無線通信，具備高吞吐量視頻流傳輸能力。這些芯片具備集成藍牙功能，同時支持Wi-Fi 5和Wi-Fi 6標準。於2020年，我們推出第一代無線連接芯片，支持Wi-Fi 5和藍牙5.0。於2023年，我們推出了更先進的具有Wi-Fi 6功能的芯片。於2024年，我們發佈了一款三模芯片，可支持三種不同的無線通信標準。該芯片集成了Wi-Fi 6、藍牙5.4和其他先進的無線技術，並支持Matter控制器和網關解決方案等智能家居協議。我們的SoC與Wi-Fi芯片具有高度兼容性，可實現無縫集成，從而提升用戶體驗、降低成本並優化性能。

下表載列Wi-Fi芯片的主要產品類別。

產品類別	產品圖片	主要特徵
WiFi-5 1x1		<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 5 + BT 5.0</li><li>• 1x1 2.4G/5G, HT80</li></ul>
WiFi-6 1x1 三合一模式		<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 6 + BT 5.4 + 802.15.4 三模式</li><li>• 1x1, 2.4G/5G, HE80</li><li>• 15.4 / Thread / Zigbee</li></ul>
WiFi-6 2x2		<ul style="list-style-type: none"><li>• Class Combo</li><li>• Wi-Fi 6 + BT 5.4</li><li>• 2x2 2.4G/5G, HE80</li></ul>
WiFi-6 2x2 三合一模式		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wi-Fi 6 + BT 5.4 + 802.15.4 三模式</li><li>▪ 2x2 2.4G/5G HE80</li><li>▪ 15.4 / Thread / Zigbee</li></ul>

---

## 業 務

---

針對中高端家用路由器、企業級無線AP及智能網關，我們亦在開發Wi-Fi AP芯片。截至2025年12月31日，我們成功完成流片階段。截至最後實際可行日期，我們亦專注於開發芯片，支持具更高併發性能及集成超低功耗的Wi-Fi 7標準。

### 光纖芯片

FTTH（光纖到戶）和FTTR（光纖到房間）已成為當前家庭寬帶的主流。憑藉我們在IP路由技術、光纖接入網絡，OLT和PON技術方面的專業知識，我們已開發FTTR網關芯片，該芯片具有專有IP（對稱GPON支持），內嵌CPU和局部端口交換功能。截至2025年12月31日，我們已完成FTTR網關芯片的流片階段。

### 蜂窩芯片

我們的蜂窩芯片支持4G與5G網絡，針對AIoT應用及車載通信進行了優化。截至2025年12月31日，我們的首款4G LTE芯片已進入量產階段，集成了射頻、基帶和電源管理模塊。這款芯片為智能穿戴設備、智能玩具等終端設備而設計。

截至2025年12月31日，我們的4G/5G雙模融合射頻芯片已成功完成流片過程和初步核驗，為在物聯網和車連網豐富產品矩陣鋪平了道路。

### 智能汽車SoC及其他芯片

我們的智能汽車SoC包括信息娛樂系統SoC及智能座艙SoC。根據弗若斯特沙利文提供的資料，汽車領域的電動化、互聯化和智能化趨勢推動了全球汽車電子市場的快速增長。

本公司的智能汽車SoC包括車載信息娛樂系統SoC（充當車載娛樂及信息平台的核心處理器）與智能座艙SoC（提供高級駕駛交互所需的算力）。我們的產品已被多家國內外主流汽車品牌採用。

### 研發

我們是晶晨半導體全球研發網絡中不可或缺的一部分，與合作夥伴緊密合作開展研發工作。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們的研發開支分別為人民幣1,282.7百萬元、人民幣1,352.7百萬元及人民幣1,551.8百萬元，分別佔相關期間我們總收入的23.9%、22.8%及22.9%。根據弗若斯特沙利文提供的資料，我們的研發開支遠高於SoC行業的平均水平。

---

## 業 務

---

### 我們的研發團隊

我們的團隊在音視頻解碼、通信、模擬及數字電路設計以及生產流程開發等領域擁有豐富的專業知識。截至2025年12月31日，我們的研發團隊包括1,684名僱員，其中49.5%擁有碩士或以上學位。我們已建立全面的研發激勵機制，連同僱員培訓及團隊建設。

### 研發過程

我們的產品開發過程包括若干關鍵階段，包括項目啟動、產品規格制定、產品設計、產品驗證及試產。我們於整個研發過程中與晶晨半導體全球研發網絡中的合夥夥伴緊密合作。

- **產品啟動**：我們的營銷部門提出新的產品開發舉措。不同的部門緊密合作以評估各項提議產品的可行性。產品提案計劃經項目評估委員會批准後，方可繼續推進。
- **產品規格制定**：批准後，技術項目經理與其他團隊合作制定研發計劃，明確產品規格、技術要求及系統設計。我們的營銷團隊隨後編製產品需求文檔並組建項目團隊，細化設計及試產的時間表。詳細計劃提交批准，且於批准後項目方可進行產品設計。
- **產品設計**：於落實產品規格及整體項目計劃後，我們的芯片設計工程師開始芯片架構設計。產品設計過程包括若干關鍵階段：(i) 模擬、邏輯及SoC設計：工程師根據產品規格定義並組織芯片的功能，將這些功能轉化為各模塊的詳細代碼；(ii) 設計驗證：設計驗證工程師（與SoC設計團隊分開）對SoC設計進行獨立審查。他們將設計與原有產品規格進行比較，以確認預期功能是否正確實現。他們利用仿真工具及（於若干情況下）現場可編程門陣列測試並驗證邏輯。一旦設計得到大幅驗證，則進入後端工程階段；(iii) 後端設計：後端工程師根據製造工藝將邏輯設計轉化為邏輯門、物理邏輯和電路結構。這一步確保可靠且高效的製造；及(iv) 流片簽核：技術項目經理啟動流片簽核流程。成功審查後，各持份者簽核設計，且項目進入製造階段。
- **流片**：我們籌備並最終確定設計數據，並將其發送至晶圓廠，以製造樣品芯片。

---

## 業 務

---

- **產品驗證**：我們的軟件研發團隊及硬件研發團隊共同監管驗證過程，測試樣品芯片的功能、性能及穩定性。倘驗證過程中發現任何缺陷，相關技術人員將調查原因並提出適當的解決方案或修訂。於樣品成功通過所有規定的驗證程序後，項目經理召開審查會議。於通過審查後，樣品進入試產階段。
- **試產**：我們的營銷部門及銷售部門連同軟件及硬件部門將選擇若干客戶參與小規模的試產活動。這可進一步測試產品於實際場景中的可靠性及適用性。倘在試點生產階段發現任何設計缺陷，團隊將評估問題，並對芯片進行必要的修正或設計修改。在新產品完成試產且無問題後，項目經理會安排召開審查會議。於通過審查後，新產品可進入大規模量產階段。

### 我們的技術

憑藉於芯片設計的多年研發經驗，我們已於整個SoC設計過程中積累豐富的專業知識。

**跨工藝芯片設計能力**：我們已在整個SoC開發流程中積累了豐富的專業知識，擅長工藝節點（包括28-nm、22-nm、12-nm、6-nm及6-nm以下）的先進設計與量產，同時可交付兼具高集成度、卓越性能與低功耗的車規級芯片。

**多媒體技術**：我們的多媒體技術支持全球最新的音視頻標準，可實現UHD視頻的流暢播放與流媒體傳輸，完全支持使用AV1、H.265及AVS 3.0視頻編解碼器的4K與8K格式。我們整合領先的Dolby與DTS技術，支持Dolby Vision、HDR10+、HDR10及HLG等HDR標準。我們的PQ引擎、運動估計與運動補償技術，以及AI驅動的超分辨率技術，可提供流暢的動態畫面與清晰的圖像。

**先進端側AI技術與處理能力**：我們的高性能神經網絡引擎支持大規模AI模型，可實現智能語音助手、增強型圖像分析等應用。我們的芯片架構可處理遠場語音識別，且我們採用可呈現清晰圖像與鮮明色彩的頂級ISP，於機器視覺方面擁有廣泛應用。

---

## 業 務

---

**全套先進的通信連接技術：**我們提供自行研發的完整有線、無線及蜂窩網絡解決方案。我們提供全套Wi-Fi 6技術，同時支持終端用戶設備(站點)與接入點。即使處在創新前沿，我們也在開發Wi-Fi 7解決方案。我們的無線技術融合多項先進特性，例如正交頻分多址(OFDMA)技術，可實現單信道同時為多個設備服務，以及多用戶多輸入多輸出(MU-MIMO)技術，允許接入點立即與多個設備進行通信。該等增強性能大幅提升了網絡效率與性能，在高密度環境中效果尤為顯著。除WLAN外，我們還支持4G LTE Cat.1 (適用於各類物聯網(IoT)設備的通用選擇)。此外，我們正開發先進的蜂窩網絡選項，包括4G Cat.4及5G精簡能力(Reduced Capability)技術，以滿足現代應用程序不斷演變的連接需求。

為滿足對高速光纖連接日益增長的需求，我們的產品組合以萬兆無源光網絡(XG-PON)及萬兆對稱無源光網絡(XGSPON)解決方案為特色，可實現高達10 Gbps的對稱速率。這些光纖技術非常適合家庭網關等高性能需求場景，我們正將其應用拓展至下一代汽車系統。我們先進的路由能力與網絡管理可確保每位用戶享受所有設備之間穩定、低延遲的連接。

**豐富的自主核心IP組合：**我們已構建廣泛的自主研發專有核心技術組合，包括神經網絡引擎、先進的ISP、音視頻編解碼器、高速外圍接口(USB、HDMI、DDR、PCI express)、網絡連接(太網、Wi-Fi、藍牙、PON)及高速模塊(SerDes、ADC)。

### 採購

根據我們的無晶圓模式，我們專注於研發及銷售，同時將晶圓生產、封裝及測試外包予第三方。

我們的銷售部門根據市況及客戶需求制定銷售計劃。我們的供應鏈管理部門編製相應的採購及生產時間表。我們直接或通過我們的全球Amlogic網絡向晶圓廠下達訂單以進行晶圓生產。完成後，晶圓交付至指定的封裝及測試服務提供商。一旦完成封裝、測試及品質核證，成品交付至我們指定的地點以供分銷。

通過與供應商合作，我們保持對所有核心知識產權的擁有權。我們與供應商訂立保密協議並評估各潛在供應商保護客戶數據的能力，包括其IT安全控制以及管理客戶技術信息的內部程序。於合作過程中，我們僅向供應商提供必要的芯片佈局信息，並不會洩露電路設計文檔或源代碼等其他核心知識產權。

---

## 業 務

---

晶圓及芯片封裝及測試服務可能因全球產能、政府法規、供需動態及地緣政治狀況等因素而產生潛在的價格波動。透過與主要供應商的長期合作關係、海外供應鏈的多元化，以及戰略採購計劃的實施，我們採購及供應的能力保持穩定。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的採購並未出現對我們的營運造成重大不利影響的質量問題或短缺。

### 我們的供應商

#### 供應商選擇及管理

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括晶圓廠及芯片封裝及測試服務提供商。於選擇供應商時，我們考慮多種因素，包括生產流程能力、生產交貨期、定價、商業條款、產品質量及服務能力。

我們定期評估供應商的表現，專注於產品品質、交付時間及服務質量。我們要求供應商定期提供質量數據及生產記錄，每年定期派遣人員至供應商的生產現場進行質量檢查。我們實施供應商評級制度，評估管理系統、生產過程及產品質量。不合規或重大質量問題即時觸發重新評估，這可能導致警告、供應限制或從合資格供應商列表中移除。

我們通常與供應商訂立框架供應協議，主要條款載列如下：

<b>期限</b>	三至五年。
<b>相關各方的主要權利及義務</b>	我們通常提供我們所購買的材料或服務的具體規格，而供應商負責確保材料或服務符合該等要求。
<b>付款及信貸條款</b>	我們根據採購訂單或協議中規定的條款付款。供應商通常授予我們30天至60天的信貸期，或要求我們預付款項。
<b>質保</b>	供應商一般提供為期一年的質保期。

## 業 務

物流	供應商通常負責將產品交付至我們指定的地點。
退貨	因供應商過錯而導致產品不符合質量要求或規格，我們有權拒收、換貨或退貨。
保密性	我們及供應商通常不得向任何第三方披露與我們合作有關的保密信息。
終止	任何一方均有權按照協議規定的條款終止協議，包括重大違約。

### 我們的主要供應商

於2023年、2024年及2025年，向五大供應商的採購額分別為人民幣2,817.9百萬元、人民幣3,259.6百萬元及人民幣4,556.7百萬元，分別佔我們採購總額的86.6%、88.0%及79.8%。此外，於2023年、2024年及2025年，向最大供應商的採購額分別為人民幣1,776.8百萬元、人民幣1,844.7百萬元及人民幣2,374.2百萬元，分別佔我們採購總額的54.6%、49.8%及41.6%。於往績記錄期間，我們的五大供應商（Amlogic Holdings Ltd.除外）均為獨立第三方。於往績記錄期間，概無我們的董事及彼等各自的聯繫人或持有我們已發行股份總數5%以上的股東於我們的五大供應商中擁有任何權益。此外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無與供應商（Amlogic Holdings Ltd.除外）發生任何重大糾紛。請參閱「— 法律訴訟及合規情況 — 出口管制合規安排」及「關連交易」。

下表載列於往績記錄期間各年度我們五大供應商的詳情：

### 截至2023年12月31日止年度

供應商	背景	所採購 材料／服務	採購成本	佔總採購額 的百分比	業務關係 開始年份
			人民幣千元		
供應商A	一家全球性的半導體晶圓代工上市公司，位於中國台灣	晶圓	1,776,812	54.6	2016年

## 業 務

供應商	背景	所採購 材料／服務	採購成本  人民幣千元	佔總採購額 的百分比	業務關係 開始年份
供應商B	一家從事半導體產品及電子產品分銷的公司，位於中國香港	晶圓	392,459	12.1	2020年
供應商C	一家從事半導體封裝及測試服務的上市公司，位於中國浙江	封裝及測試服務	267,014	8.2	2022年
供應商D	一家從事半導體封裝及測試服務的上市公司，位於中國江蘇	封裝及測試服務	202,906	6.2	2016年
供應商E	一家全球領先的從事IP設計及相關服務的上市公司的子公司，位於中國重慶	IP	178,673	5.5	2018年
<b>總計</b>			<b><u>2,817,864</u></b>	<b><u>86.6</u></b>	

### 截至2024年12月31日止年度

供應商	背景	所採購 材料／服務	採購成本  人民幣千元	佔總採購額 的百分比	業務關係 開始年份
供應商A	一家全球性的半導體晶圓代工上市公司，總部位於中國台灣	晶圓	1,844,707	49.8	2016年
供應商B	一家從事半導體產品及電子產品分銷的公司，位於中國香港	晶圓	703,263	19.0	2020年
供應商C	一家從事半導體封裝及測試服務的上市公司，位於中國浙江	封裝及測試服務	322,567	8.7	2022年
供應商F	一家從事半導體封裝及測試服務的公司，位於中國江蘇	封裝及測試服務	207,282	5.6	2021年

## 業 務

供應商	背景	所採購 材料／服務	採購成本	佔總採購額 的百分比	業務關係 開始年份
			<i>人民幣千元</i>		
供應商E	一家全球領先的從事IP設計及相關服務的 上市公司的子公司，位於中國廣東	IP	181,773	4.9	2018年
<b>總計</b>			<b>3,259,592</b>	<b>88.0</b>	

### 截至2025年12月31日止年度

供應商	背景	所採購 材料／服務	採購成本	佔總採購額 的百分比	業務關係 開始年份
			<i>人民幣千元</i>		
供應商A	一家全球性的半導體晶圓代工上市公 司，總部位於中國台灣	晶圓	2,374,212	41.6	2016年
供應商B	一家從事半導體產品及電子產品分銷 的公司，位於香港	晶圓	1,386,386	24.3	2020年
Amlogic Holdings Ltd.	該公司提供提供勞務與技術，位於開 曼群島	研發服務	332,375	5.8	2024年
供應商F	一家從事半導體封裝及測試服務的公 司，位於中國江蘇	封裝及測試 服務	246,603	4.3	2021年
供應商D	一家從事半導體封裝及測試服務的 上市公司，位於中國江蘇	封裝及測試 服務	217,086	3.8	2016年
<b>總計</b>			<b>4,556,662</b>	<b>79.8</b>	

### 依賴若干供應商

於往績記錄期間，我們主要向供應商A（一家領先的半導體製造商）採購晶圓。於2023年、2024年及2025年，我們向供應商A的採購額分別佔我們採購總額的54.6%、49.8%及41.6%。我們自2016年起開始與供應商A合作，且已通過長期協議與供應商A建立穩定的關係。根據弗若斯特沙利文提供的資料，芯片設計公司依賴少數晶圓廠合

---

## 業 務

---

作夥伴以確保品質一致的產品及集中管理生產需求，這符合行業慣例。基於上述者，我們認為我們與現有主要供應商已建立長期且穩定的關係，且我們的供應商集中風險屬可控。請參閱「風險因素－我們從少數供應商採購若干對我們經營關鍵的服務」。

鑒於特殊的工藝技術要求及所涉及的IP，我們通常就每款產品僅與一家代工廠合作。為增強我們供應鏈的韌性，我們定期審查及評估在一系列流程節點上具備成熟能力以及已確定符合國際質量及可靠性標準的替代供應商。我們持續致力於開發自主IP進一步提升我們在必要時靈活切換供應商的能力。儘管有其他可用的代工廠，但能夠滿足我們全系列產品所需的先進工藝節點、性能規格及質量標準的供應商數量有限。董事認為，我們與供應商A的關係不大可能出現重大不利變動或終止，是因為(i)我們已與供應商A維持長期穩定的合作關係，及(ii)於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與供應商A並無任何糾紛。

於芯片封裝及測試方面，我們主要與多家封裝及測試供應商合作。我們基於該等合作夥伴的技術專長對其進行甄選，並分配產量以平衡產能並降低供應鏈風險。我們了解到有其他替代封裝及測試提供商，可以合理的商業條款提供與供應商C及供應商D目前所供應產品在價格、產品質量及交付週期方面相若的產品。

倘需過渡至替代供應商，我們將遵循供應商准入流程。此流程包括對生產流程能力、交貨期、定價、商業條款、產品質量及服務表現等因素進行全面評估。於任何過渡期間，我們與供應商建立的良好關係及積極主動的管理實踐有助於減少潛在的營運中斷，並確保平穩過渡。請參閱「法律訴訟及合規情況－出口管制合規安排」。

## 銷售、營銷及分銷

### 我們的銷售網絡

於往績記錄期間，我們的產品銷往全球。我們主要依賴專業分銷商推廣及銷售產品。我們亦在較小程度上直接向客戶銷售。下表載列所示年度按銷售渠道劃分的收入貢獻明細。

## 業 務

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
分銷 .....	4,216,262	78.5	4,642,045	78.3	5,300,615	78.1
直銷 .....	1,154,680	21.5	1,284,270	21.7	1,489,967	21.9
<b>總計 .....</b>	<b>5,370,942</b>	<b>100.0</b>	<b>5,926,315</b>	<b>100.0</b>	<b>6,790,582</b>	<b>100.0</b>

在決定直銷或通過分銷商銷售時，我們會考慮以下因素：(i)終端客戶的採購偏好或政策，(ii)渠道管理及市場擴張需求，及(iii)銷售資源分配。

### 我們的分銷渠道

#### 概覽

於往績記錄期間，我們主要通過第三方專業分銷商銷售並推廣我們的產品。我們在我們無法直接有效觸達終端客戶的市場、地區或客戶細分領域，與分銷商合作以提高銷售效率。分銷商協助提供銷售渠道資源、管理客戶關係、評估下游需求以及提供銷售支持。

在部分情況下，我們與終端客戶保持直接溝通，以確保產品符合彼等要求，而終端客戶指定首選分銷商完成銷售流程。該模式令我們能夠與終端客戶保持緊密聯繫並深入了解其需求，同時利用分銷商的能力進行本地履約及物流支持。根據弗若斯特沙利文提供的資料，半導體行業的公司委聘分銷商屬常見。根據我們對分銷商銷售報告及出貨記錄的定期審閱及審計，我們相信，我們於往績記錄期間並無任何二級分銷商。

截至2025年12月31日，我們有23名分銷商。下表載列我們於所示期間的分銷商數目變動。

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
年初分銷商 .....	22	22	21
新增分銷商 .....	0	0	2
終止現有分銷商 .....	0	1	0
<b>年末分銷商 .....</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>23</b>

---

## 業 務

---

隨著我們擴大客戶基礎，我們於2025年應終端客戶的要求委聘兩名新分銷商，以提高市場覆蓋率。我們於2024年終止與一名分銷商的合作，主要由於我們先前通過分銷商服務的終端客戶已轉為與我們直接銷售的模式。

產品分銷收入於產品控制權轉移，即分銷商確認收貨時確認。倘產品已運抵指定地點，過時及遺失的風險已轉移至分銷商，且滿足以下任一條件：分銷商已根據銷售合約驗收產品、驗收條文已失效或我們持有客觀證據證明所有驗收標準均已滿足，則視為交付發生。

據我們所深知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的所有分銷商均為獨立第三方。

### **與分銷商的主要合同條款**

我們與分銷商的關係分類為買賣關係。於往績記錄期間，我們通常與各分銷商訂立分銷協議。我們分銷協議的主要條款包括以下各項：

**付款及信貸條款** 我們通常要求分銷商於產品發貨前向我們支付全部預付款。

**定價** 我們通常向分銷商提供建議價格範圍。未經我們事先授權，分銷商不得偏離報價。

**指定分銷** 分銷商僅限於按照雙方共同確定的客戶覆蓋範圍及／或分銷區域銷售產品。

**銷售折扣** 我們通常不對分銷商設定最低銷售目標。於達到特定銷售門檻後，我們將提供返利激勵。

**物流** 我們通常負責將貨物備好，以供分銷商在每個訂單中指定的地點提取。

**退貨** 我們通常不允許分銷商退貨，惟產品質量問題由我們造成者則除外。

---

## 業 務

---

**風險轉移** 風險於分銷商確認收到我們的產品後轉移。

**終止** 如分銷商違約，我們通常有權終止分銷協議。分銷商通常有權透過發出提前45天的書面通知終止協議。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與分銷商並無任何重大的未解決糾紛或訴訟。

### 分銷商選擇及管理

我們根據多種因素選擇分銷商，包括其往績記錄、銷售經驗、財務表現、聲譽及渠道資源。於若干情況下，待我們與終端客戶就供應條款達成協議後，終端客戶會指定其首選分銷商來完成交易。

我們定期為分銷商提供業務培訓及市場指導，並定期評估其在銷售、市場拓展、存貨管理及客戶服務質量方面的表現。業績出色的分銷商可獲得額外的資源及優惠政策。對於表現不佳的分銷商，我們提供指導，必要時可能終止合作關係。

我們的分銷商採用買斷模式經營。除非因我們的過錯導致質量問題，否則我們不允許分銷商退回未售出的產品。我們監控分銷商的存貨，要求彼等提交採購訂單、銷售報告及存貨報告、下游客戶訂單及出貨文件。倘我們發現任何差異（如分銷商的存貨水平與約定的交貨計劃不符），我們會立即與分銷商及相關客戶合作，調查並解決問題，從而將渠道填塞風險降至最低。

我們亦通過以下措施謹慎管理分銷渠道，以降低蠶食的風險：(i)我們向分銷商授予專屬地區以便我們可降低不同分銷商之間的競爭水平。我們一般訂明指定地區，且一般禁止分銷商向各個指定地區外銷售產品。我們通過分析客戶需求、區域銷售潛力及現有市場需求等因素釐定分銷商地理區域；及(ii)我們對分銷商的多維度評估考慮了其對不同行業的業務兼容性及產品線的適用性。根據評估結果，我們針對不同行業的不同終端客戶，量身定制分銷策略，發揮各分銷商的優勢，通過有效的資源配置及協調，降低蠶食風險。

---

## 業 務

---

### 直銷

於往績記錄期間，我們小部分產品直接銷售予客戶。我們的直銷客戶主要包括消費類電子OEM。採用直銷方式能夠使我們直接了解及回應客戶的需求。

我們於往績記錄期間的標準直銷協議的主要條款如下。

**期限** 通常一至三年。

**付款及信貸條款** 我們通常向直銷客戶授予30至45天的信貸期。

**定價** 我們通常在與客戶協商後，按照採購訂單上的價格銷售產品。

**物流** 我們通常負責將產品交付至協議指定的地點，以供客戶驗收。

**退貨** 如產品質量問題由我們造成，直銷客戶有權向我們退貨。

**保密性** 我們及客戶通常不得向任何第三方披露與我們合作有關的保密信息。

**終止** 任何一方均有權按照協議規定的條款終止協議，包括重大違約。

於2023年、2024年及2025年，直銷客戶產生的收入分別為人民幣1,154.7百萬元、人民幣1,284.3百萬元及人民幣1,490.0百萬元，分別約佔同年總收入的21.5%、21.7%及21.9%。

### 客戶服務及技術支持

我們提供在線客服支持，並為重要客戶派遣現場技術支持工程師。來自兩個渠道的反饋會直接傳達給我們的銷售團隊，以便即時回應客戶需求。

## 業 務

### 定價

我們基於多種因素來為產品定價，包括(i)相關產品的成本(ii)預期利潤率，(iii)競爭格局，及(iv)客戶議價能力。當我們根據該等因素設定基本價格，我們便會根據客戶的具體要求按個別基準調整定價。

### 營銷

我們主要通過線下渠道推廣我們的產品。我們的銷售團隊積極參與客戶開發及關係管理。我們參加知名的行業展會，包括在洛杉磯舉辦的國際消費電子展，荷蘭廣播電視通信設備展覽會。

### 客戶

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括分銷商。於2023年、2024年及2025年各年，我們的五大客戶合共產生的收入分別為人民幣3,519.0百萬元、人民幣3,752.2百萬元及人民幣4,333.9百萬元，分別佔我們總收入的65.5%、63.3%及63.8%。於2023年、2024年及2025年各年，來自我們最大客戶的收入分別為人民幣1,317.4百萬元、人民幣1,109.9百萬元及人民幣1,544.5百萬元，分別佔我們總收入的24.5%、18.8%及22.7%。於往績記錄期間，我們的五大客戶均為獨立第三方。於往績記錄期間，概無董事及彼等各自的聯繫人或持有已發行股份總數5%或以上的股東於我們的任何五大客戶中擁有任何權益。

下表載列於往績記錄期間我們五大客戶的資料：

#### 截至2023年12月31日止年度

客戶	背景	向客戶售出的產品	銷售所得 收入	佔總收入 百分比	信貸期	業務關係 開始年份
客戶A	一家從事電子通信設備及零部件批發以及電子零部件批發進口的領先公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC、通信與連接芯片及智能汽車SoC	1,317,364	24.5	預付款	2017年

人民幣千元

## 業 務

客戶	背景	向客戶售出的產品	銷售所得 收入	佔總收入 百分比	信貸期	業務關係 開始年份
<i>人民幣千元</i>						
客戶B	一家從事專業電子元件分銷及提供系統解決方案的全球領先公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	841,086	15.7	預付款	2018年
客戶C	一家主要從事電子產品銷售的領先上市公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	469,817	8.7	30天	2018年
客戶D	一家主要從事電子產品銷售的公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	459,938	8.6	預付款	2017年
客戶E	一家主要從事無線通信產品綜合解決方案研發、生產與銷售的上市公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	430,802	8.0	預付款	2020年
<b>總計</b>			<b><u>3,519,007</u></b>	<b><u>65.5</u></b>		

### 截至2024年12月31日止年度

客戶	背景	向客戶售出的產品	銷售所得 收入	佔總收入 百分比	信貸期	業務關係 開始年份
<i>人民幣千元</i>						
客戶B	一家從事專業電子元件分銷及提供系統解決方案的全球領先公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	1,109,913	18.8	預付款	2018年

## 業 務

客戶	背景	向客戶售出的產品	銷售所得 收入	佔總收入 百分比	信貸期	業務關係 開始年份
			<i>人民幣千元</i>			
客戶A	一家從事電子通信設備及零部件批發以及電子零部件批發進口的領先公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC、通信與連接芯片及智能汽車SoC	985,182	16.6	預付款	2017年
客戶E	一家主要從事無線通信產品綜合解決方案研發、生產與銷售的上市公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	595,282	10.0	預付款	2020年
客戶D	一家主要從事電子產品銷售的公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	591,502	10.0	預付款	2017年
客戶C	一家主要從事電子產品銷售的領先上市公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	470,290	7.9	30天	2018年
總計			<u>3,752,169</u>	<u>63.3</u>		

### 截至2025年12月31日止年度

客戶	背景	向客戶售出的產品	銷售所得 收入	佔總收入 百分比	信貸期	業務關係 開始年份
			<i>人民幣千元</i>			
客戶A	一家從事電子通信設備及零部件批發以及電子零部件批發進口的領先公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC、通信與連接芯片及智能汽車SoC	1,544,521	22.7	預付款	2017年

## 業 務

客戶	背景	向客戶售出的產品	銷售所得 收入	佔總收入 百分比	信貸期	業務關係 開始年份
			<i>人民幣千元</i>			
客戶B	一家從事專業電子元件分銷及提供系統解決方案的全球領先公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	1,064,487	15.7	預付款	2018年
客戶C	一家主要從事電子產品銷售的領先上市公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	597,224	8.8	30天	2018年
客戶E	一家主要從事無線通信產品綜合解決方案研發、生產與銷售的上市公司	智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC及通信與連接芯片	590,052	8.7	預付款	2020年
客戶F	一家從事原材料採購、半成品生產，以及電子產品設計與銷售的上市公司	智能多媒體及顯示SoC及AIoT SoC	537,583	7.9	30天	2017年
總計			<u>4,333,867</u>	<u>63.8</u>		

於往績記錄期間，我們收入的很大一部分來自五大客戶（大多數為分銷商）。我們與五大客戶維持了5至8年的長期穩定合作關係。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無與任何五大客戶發生任何重大糾紛。

### 轉讓定價安排

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已進行若干受轉讓定價安排所規限的集團內公司間交易。有關交易主要包括(i)有形資產所有權交易，指出售產成品，(ii)無形資產使用權交易，指技術許可，及(iii)服務交易，指研發及營銷服務（統稱為「受限交易」）。我們按經濟合作與發展組織（「經合組織」），開展國際合作的國際組織）

## 業 務

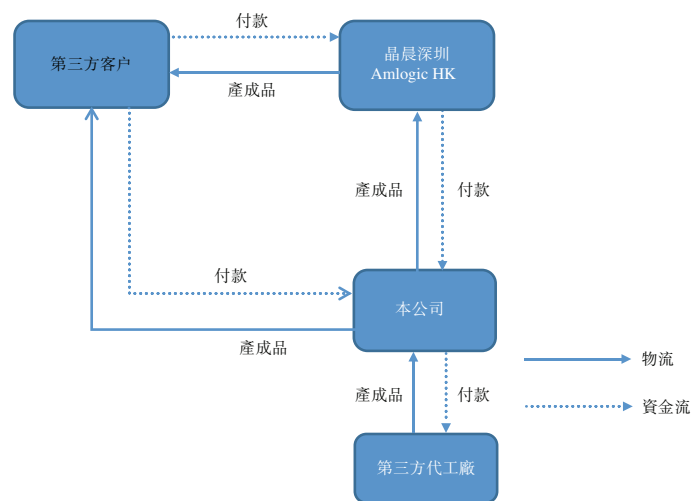
頒佈的跨國企業與稅務機關轉讓定價指南（「經合組織轉讓定價指南」）及我們經營業務所在司法權區適用法律法規所載遵循集團內公司間交易必須公平交易基準進行的基本原則。

下表載列我們於往績記錄期間重大集團內公司間交易的金額：

	貨幣	截至12月31日止年度		
		2023年	2024年	2025年
有形資產所有權交易	人民幣千元	1,789.9	1,107.2	3,301.0
	千美元	665,696.2	745,813.6	833,178.7
無形資產使用權交易	人民幣千元	429,453.3	481,692.2	524,655.7
	千美元	–	5,865.7	10,722.5
服務交易	人民幣千元	186,198.9	198,036.3	172,266.4
	千美元	33,016.1	35,176.8	52,303.9

### 有形資產所有權交易

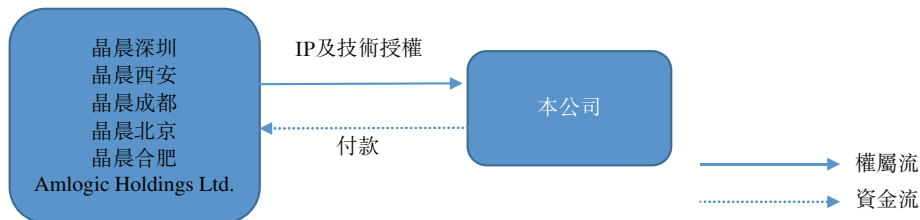
於銷售產成品時，本公司作為首要責任方，而Amlogic HK及晶晨深圳擔任有限風險經銷商，向本公司採購產成品後轉售予第三方客戶。下圖載列產成品銷售的交易流程：



## 業 務

### 無形資產使用權交易

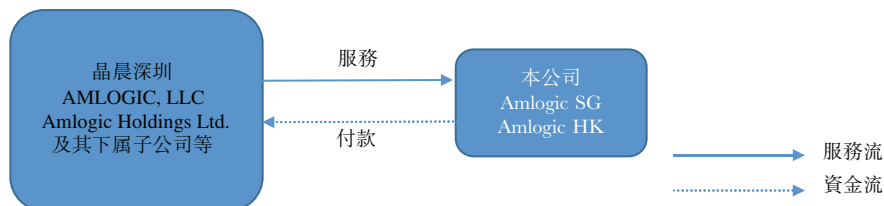
於往績記錄期間，(i)晶晨深圳、晶晨半導體科技(北京)有限公司(「晶晨北京」)、晶晨半導體(西安)有限公司(「晶晨西安」)、晶晨芯半導體(成都)有限公司(「晶晨成都」)及合肥晶晨芯片半導體有限公司(「晶晨合肥」)將自主研發的技術授權本公司使用，及(ii)Amlogic Holdings Ltd.將外部購買的IP權授權本公司使用，本公司向該等實體支付許可費。下圖載列IP及技術授權的交易流程。



### 服務交易

於往績記錄期間，(i)Amlogic Singapore Private Limited (「Amlogic SG」)、Amlogic Korea Limited (「Amlogic Korea」)、晶晨深圳、晶晨北京、晶晨西安、晶晨成都、晶晨半導體(南京)有限公司(「晶晨南京」)、晶晨合肥、Amlogic (CA) Co.,Inc.、Amlogic, LLC及Amlogic Holdings Ltd.向本公司提供研發服務。

此外，本公司、晶晨深圳、晶晨北京、晶晨成都、Amlogic Korea、Amlogic (CA) Co.,Inc.及Amlogic Holdings Ltd.向Amlogic HK提供營銷服務，並收取相應服務費。下圖載列服務交易的交易流程。



我們委聘獨立轉讓定價稅務顧問(「轉讓定價顧問」)對受限交易進行轉讓定價評估及基準研究。於評估時，轉讓定價顧問採納交易淨利潤法(「TNMM」)(行業普遍認可的盈利能力評估方法)，並選取了恰當的利潤水平指標(包括分銷業務的經營利潤率及服務業務的完全成本加成率)。針對技術及IP授權業務採用了兩種評估方法：(i)可比

---

## 業 務

---

非受控價格法(CUP) (針對自主研發的技術許可) 及(ii)交易淨利潤法 (針對已購知識產權授權服務)。轉讓定價顧問通過選取可比獨立公司開展基準分析，為各類交易設定了公平交易的區間範圍。

基於上述基準分析，轉讓定價顧問得出結論：本集團各相關實體就其所履行職能所獲取的利潤，在所有重大方面均未違反公平交易原則。基於上述者，我們的轉讓定價顧問認為，且聯席保薦人認同，於往績記錄期間，我們的轉讓定價安排未違反相關司法權區的適用法律法規。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因該等集團內公司間交易及轉讓定價安排而受到中國及其他相關稅務司法權區的任何稅務機關的任何未結問詢、審計、調查或質疑。

董事確認，為確保持續遵守適用的轉讓定價法律法規，我們進行集團內公司間交易時堅持公平原則，並考慮成本、市價、各實體的職能及風險等因素，相應地採取合理的定價方法。我們已採納並將繼續採納以下內部控制措施以確保持續符合中國相關轉讓定價法律法規及經合組織轉讓定價指南：(i)我們將持續聘請外部轉讓定價顧問每年就轉讓定價事宜向我們提供建議。我們將持續遵循轉讓定價顧問有關轉讓定價方法的應用及評估出具的建議；(ii)我們將就相關司法權區相關轉讓定價法律法規的最新情況，向財務團隊提供培訓；(iii)我們的財務部將在向相關稅務機關提交所有轉讓定價相關申報表格前對其進行審核；(iv)我們的高級管理層將確保所採納的轉讓定價政策與符合各實體的價值貢獻一致；(v)我們的高級管理層將審閱重大集團內公司間交易的條款，並定期監察我們的轉讓定價政策，以確保交易按照公平交易原則進行；及(vi)我們的財務部將就各方的價值貢獻記錄並歸檔相關支持文件，以作風險管理之用。文件將包括但不限於與職能及風險特徵相關的文件、往來通信等。

經審閱本集團針對集團內公司間交易的內部控制措施，並與轉讓定價顧問討論後，聯席保薦人未發現任何事項，致使其對上述內部控制措施在確保持續遵守相關轉讓定價法律法規方面的充分性產生任何疑慮。

---

## 業 務

---

### 第三方付款安排

#### 背景

於往績記錄期間，我們的若干客戶（個別或統稱「**相關客戶**」）透過其指定的第三方付款人賬戶與我們結算付款（「**第三方付款安排**」）。該等第三方付款安排係應相關客戶要求而設立。據我們所深知，指定的第三方付款人主要由專業進出口貿易商及供應鏈解決方案供應商組成，彼等根據其與相關客戶的協議向我們付款。

我們的中國法律顧問認為，第三方付款安排並未違反中國任何適用法律法規，其依據如下：(i)根據《中華人民共和國民法典》，當事人只要具備行為能力、意願真實，且安排不違反強制性法律或有悖於公共秩序及良好道德，即可自主訂立民事法律行為；(ii)第三方付款安排具法律效力，因其體現買方、賣方及付款方之意思自主性，並以委託付款確認書及相關協議載明，且協議內容未違反強制性法律或公序良俗；及(iii)第三方付款安排下未發現商業賄賂、洗錢、逃稅或爭議，且本集團就此未受任何行政處罰。

於2025年9月，我們已終止所有第三方付款安排。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾收到任何第三方付款人的索償。

#### 強化內部控制措施

為防止未來再次發生第三方付款安排，我們已採取或計劃採取下列強化內部控制措施：(i)我們要求所有客戶直接透過其於買賣協議中的自有公司銀行賬戶結算付款；(ii)我們進一步強化認識你的客戶程序，以全面了解我們的客戶，並根據我們的記錄核實付款詳情以確認付款乃根據協議作出；及(iii)我們更新付款政策，明確禁止第三方付款安排。內部付款政策制定了清晰的付款核驗及審核機制，以確保所有付款均符合我們的財務政策及相關法規。我們的內部控制顧問已審閱上述內部控制措施，並無發現任何重大缺陷。

## 業 務

### 知識產權

截至2025年12月31日，我們於國內外獲授373項專利，93項著作權、76項註冊商標及3個域名。我們通過自主開發獲得專利。截至最後實際可行日期，我們擁有我們所有的專利及專利申請，且並無與第三方共同擁有或共享我們的專利及專利申請的安排。有關我們作為註冊擁有人的核心技術優勢的重大知識產權組合，請參閱「附錄七－法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－2.知識產權」。

我們的核心技術包括跨流程芯片設計能力、多媒體技術、先進端側AI計算與處理能力，以及各類先進通信與連接技術。這些功能使終端產品（如電視）能夠提供更清晰、更生動的圖像，並具有更佳的觀看體驗。通過提供此類改進，我們幫助客戶在競爭激烈的市場中脫穎而出。

我們主要依賴專利、著作權、商標法、商業機密保護以及與客戶、供應商及僱員簽訂的保密協議來保護我們的知識產權。我們在與僱員及業務合作夥伴訂立的協議中清楚列明有關知識產權所有權及保護的所有權利及義務。此外，我們亦透過維護辦公室的實體安全以及信息技術系統的實體及電子安全，來確保數據及商業機密的完整性及保密性。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遭遇任何已威脅提出或待決的與知識產權侵權相關的會對我們的業務產生重大不利影響的爭議。請參閱「風險因素－我們可能無法於全球範圍內保護我們的知識產權，且倘我們的知識產權遭第三方侵犯，我們的競爭能力可能會受到損害」。

### 質量控制

我們已實施全面的質量保證制度，確保從研發及設計到生產的嚴格控制。我們已獲得ISO9001質量管理體系認證。在芯片設計期間，我們進行嚴格的設計驗證及可靠性測試。在晶圓製造方面，我們與代工廠密切合作，並設定明確的收益率要求。就封裝而言，我們要求供應商滿足明確的良率預期，並實施嚴格的質量控制。在測試期間，我們要求供應商進行樣品檢驗，供應商對結果的準確性及可靠性全權負責。此外，我們接受第三方認證機構的全面年度審核，借助外部專業力量識別潛在的質量問題。對於審核過程中發現的任何問題，我們已建立快速響應機制，以確保及時補救，同時制定預防措施，避免問題再次發生。我們已建立嚴格的質量召回管理程序。當客戶反映出現異常時，我們的質量工程師會進行故障分析及我們將評估召回是否必要。於往績記錄期間，我們並無發生任何與產品召回、退貨、換貨或客戶投訴有關且對我們的業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響的事件。

## 業 務

### 存貨管理

我們的存貨主要包括原材料（未測試的晶圓及記憶體模組）、在製品（封裝及測試中的芯片）、製成品及在途貨品。請參閱「財務資料－節選資產負債表項目的討論－存貨」。我們已實施以下措施優化我們的存貨水平：(i)我們的銷售部門每月向運營部門提交一份滾動12個月客戶銷售預測。運營團隊則將該等預測與過往銷售數據一併審查，並為不同的客戶及產品類別安排生產規劃會議。基於該等討論，我們制定準確的生產及交付計劃，確保存貨保持在安全、最佳水平；(ii)對於晶圓採購，我們通常按月下訂單，如有需要會額外安排訂單以應對特定情況。對於封裝及測試服務，我們向供應商提供涵蓋至少未來三個月的滾動生產預測，每月更新以確保準確性並實現及時的產能規劃；及(iii)我們採用倉庫管理系統（貫穿整個倉儲流程）。這使得庫存數據可實現實時同步，並可智能分配存儲空間。在物流環節，我們使用高精度的GPS定位系統以實現按時交付。

於2023年、2024年及2025年，我們的存貨週轉天數分別為164.0天、155.9天及189.5天。

### 信息安全及數據隱私

數據隱私及網絡安全已成為治理的關鍵優先事項，隨著中國當局定期出台新的網絡安全、數據安全及隱私法律法規，這一點顯得尤其重要。

在業務運營方面，我們收集、儲存並處理業務數據及交易數據，包括我們與客戶、供應商及其他相關方的業務及交易相關的數據。鑒於我們僅與企業進行交易，因此我們的業務一般不涉及收集或處理客戶個人信息。為降低數據安全風險，我們已實施一套全面的方法（包括採用加密及訪問控制環境的安全的數據儲存協議、定期備份，以及災難恢復方案）、先進的技術防禦手段（包括端點保護、下一代防火牆、實時入侵防禦以及系統漏洞管理）。我們的僱員每年均會接受安全培訓。我們要求供應商持有ISO 27001標準認證，所有外部訪問均受到嚴格監控並受合同約束。

於往績記錄期間，我們概無任何可能對我們業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的客戶機密資料外洩或任何其他客戶資料相關事故。

## 業 務

### 競爭

我們經營所在全球智能終端SoC行業極具競爭力，且具有廣泛的下游應用特點。按收入計，全球智能終端SoC市場從2020年的419億美元增加至2024年的657億美元，2020年至2024年的複合年增長率為11.9%。預期於2029年前，全球智能終端SoC市場規模將進一步增至1,314億美元，2024年至2029年的複合年增長率為14.9%。

我們主要與國內外SoC提供商展開競爭，其中部分提供商的市場份額較高。主要競爭因素包括技術專長、研發能力、多樣化的可複用IP資產組合、銷售與營銷能力、供應鏈管理以及品牌和聲譽。根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年的相關收入計，我們在專注於智能終端SoC芯片的廠商中位列全球第四（全球市場份額為1.2%），在全球智能家庭終端SoC市場中位列中國大陸第一、全球第二（全球市場份額為17.7%）。請參閱「行業概覽」。

### 保險

我們為業務的各方面投保，包括財產全險、公眾責任險、運輸保險及補充醫療保險。我們相信，我們現有的保險範圍足以涵蓋我們的業務營運，並符合一般市場慣例。

於往績記錄期間，我們並無任何重大保險索償。然而，我們可能面臨超出我們保險範圍的申索及責任。請參閱「風險因素－我們的保險覆蓋範圍可能不足以應對業務風險」。

### 僱員

截至2025年12月31日，我們共有1,945名全職僱員。於往績記錄期間，我們絕大多數僱員均位於中國內地。下表載列截至2025年12月31日按職能劃分的僱員明細。

職能	人數	佔總數的百分比 (%)
技術 .....	1,684	86.6
行政 .....	117	6.0
生產 .....	73	3.8
銷售 .....	44	2.3
財務 .....	27	1.4
<b>總計 .....</b>	<b>1,945</b>	<b>100.0</b>

## 業 務

我們認為，我們的長期增長取決於我們僱員的專業知識、經驗及發展。我們主要通過推薦、招聘網站及校園招聘來招聘僱員。我們定期對僱員進行績效評估，對其表現及個人技能提供反饋。我們的僱員薪酬通常包括基本工資及績效獎金。我們亦為僱員提供系統培訓，使其具備勝任工作所需的技能及知識。

我們與僱員訂立標準僱傭協議，涵蓋保密、知識產權、僱傭、商業道德及不競爭等事宜，尤其是，其受僱於我們期間及之後生效的不競爭條款及保密條款。根據中國法律法規的規定，我們參與多項政府法定僱員福利計劃，包括社會保險計劃，即養老、醫療、失業、工傷及生育保險計劃以及住房公積金。截至2025年12月31日，我們的僱員並無工會代表。我們相信，我們與僱員維持良好的合作關係，且於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遭受任何重大勞資糾紛、罷工、抗議或就我們的營運於招募員工時面臨困難。

### 牌照、批准及許可

經我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已自相關政府機關取得對我們在中國的業務營運而言屬重大的所有必要牌照、許可、批准及證書，且該等牌照及許可於最後實際可行日期仍具完全效力，並未被撤銷或取消。下表載列我們於往績記錄期間在中國的重要牌照及許可詳情。

牌照、許可及批准類別	頒發機構	頒發日期	到期日
中華人民共和國海關報關 單位註冊登記證書 .....	浦東海關	2017年5月12日	不適用
中華人民共和國海關報關 單位註冊登記證書 .....	深圳海關	2014年10月21日	不適用

### 物業

截至2025年12月31日，我們在中國及美國擁有及租賃若干物業，主要用作辦公及研發用途。根據上市規則第5.01A及5.01B條，倘構成申請人物業活動一部分的物業權益（定義見上市規則第5.01(3)條）的賬面值（定義見上市規則第5.01(1)條）佔申請人總資產的1%或以上，則文件必須載有該物業權益的估值報告全文。截至2025年12月31日

---

## 業 務

---

(即本集團最近期經審計綜合財務狀況表的日期)，(i)我們投資物業的賬面值超過我們總資產的1%；及(ii)我們非物業活動中並無單一物業權益的賬面值佔總資產的15%或以上。請參閱「附錄三－物業估值報告」。

### 自有土地及物業

截至2025年12月31日，我們在中國擁有2個物業，總面積為10,159.7平方米，主要用於辦公用途。根據我們的中國法律顧問的意見，我們依法享有該等物業的所有權，並有權根據適用中國法律佔用、使用、轉讓、按揭或以其他方式處置該等物業。

截至2025年12月31日，我們在美國擁有1個物業，總面積為17,620平方英尺，主要用於辦公用途。該等財產合法有效，且我們的所有權並不存在爭議或潛在爭議。

### 租賃物業

截至2025年12月31日，我們在中國擁有14個租賃物業，總面積為14,255.6平方米，主要用於辦公及研發用途。就我們所租賃的所有物業而言，出租人已取得相關業權證明文件及／或令出租人有權出租該等物業的同意書、授權或批文。

根據適用的中國法律法規，物業租賃協議須在中國住房和城鄉建設部相關地方部門登記。截至最后實際可行日期，我們在中國租賃的3個物業尚未完成租賃登記。未能取得租賃協議登記主要是由於出租人未能配合。根據相關中國法律及法規，我們可能會被相關政府機關責令於規定期間內登記相關租賃協議，否則我們可能就每項未登記租賃被處以介乎人民幣1,000元至人民幣10,000元的罰款。誠如我們的中國法律顧問所告知，未進行租賃協議登記並不影響該等租賃協議的有效性，且我們的經營亦不會受到任何重大不利影響。

### 法律訴訟及合規情況

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規情況產生重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政訴訟(包括任何破產或接管程序)。

## 業 務

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾涉及任何導致罰款、強制行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件可能個別或共同對我們的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

### 出口管制合規安排

#### 背景

於往績記錄期間，身為一家半導體設計公司，我們委託第三方晶圓廠提供晶圓製造服務，並在研發過程中採用來自第三方供應商的架構IP、設計軟件及工具。

該等海外晶圓廠、IP廠商、設計軟件與工具廠商部分受美國不同層級的出口管制法規規範，此將影響其客戶篩選及供應鏈管理方式。為維持我們的競爭優勢、可持續發展及遵循法規，我們已透過與主要股東Amlogic Holdings Ltd.的關係，藉由下列安排優化業務營運：

- (i). 根據1月16日規則（定義見下文），Amlogic Holdings Ltd.擁有一家全資子公司，該子公司為獲授權芯片設計商（「獲授權芯片設計商子公司」）；
- (ii). 獲授權芯片設計商子公司自2025年2月起遵照1月16日規則（定義見下文）下達晶圓製造訂單。1月16日規則規定，我們部分採用16/14納米節點製程之產品屬「適用先進邏輯集成電路」，這使「前端製造商」及「外包半導體封裝與測試公司（OSAT）」須向美國商務部工業與安全局（BIS）遵守若干申報規定；
- (iii). Amlogic Holdings Ltd.已依據供應商（「知識產權軟件供應商」）之適用使用條款，與我們共享其使用之部分知識產權、設計軟件及工具。請參閱「關連交易」。儘管我們可利用我們的全球網絡關係，向該等供應商的中國分支機構直接採購該等物品，但於1月16日規則（定義見下文）實施前，我們已選擇向Amlogic Holdings Ltd.採購該等物品。此安排對運營而言在商務上屬切實可行且具成本效益，而我們無理由選擇將產生更高財務成本及行政負擔的獨立授權安排。

該等安排（統稱「出口管制合規安排」）乃為確保於往績記錄期間因應美國出口管制法規之制訂及變更而遵守相關規定而設立。

## 業 務

我們已評估該等知識產權軟件供應商之中國分支機構可供應之可資比較知識產權、設計軟件及工具。截至最後實際可行日期，該等可資比較知識產權、設計軟件及工具均可供中國內地採購。因此，我們認為，若有意僅就中國運營訂立獨立授權安排，我們可購買該等可資比較產品。我們亦已實施預防措施，確保持續獲得晶圓服務、知識產權、設計軟件及工具，同時遵守適用之美國出口管制規定。

由於實施出口管制合規安排，我們於2024年開始向Amlogic Holdings Ltd.採購若干研發及配套服務，並就採購晶圓製造服務向Amlogic Holdings Ltd.及其子公司支付費用。有關款項包括(i)晶圓廠收取的實際成本，及(ii)按晶圓廠實際成本加成固定比例的金額，加上光罩折舊費(「**製造採購加成**」)。請參閱「關連交易」。於2024年，該金額為人民幣66.18百萬元，佔我們2024年銷售成本及研發開支總額的1.3%。於2025年，向Amlogic Holdings Ltd.採購的知識產權、軟件及工具總額，以及針對16納米以下產品的製造採購加成，共計人民幣328.19百萬元，佔我們2025年銷售成本及研發開支總額的5.7%。

### 《出口管理條例》概覽

由美國商務部工業與安全局(「**BIS**」)頒佈實施的《出口管理條例》(「**EAR**」)，規範受美國管轄之物品的出口、再出口及轉讓。EAR適用於：

- (i). **美國原產物品**：自美國出口的貨品、軟件及技術，或不論位於何處的美國原產物品；
- (ii). **含有美國管制成分的境外製造物品**：於美國境外生產、且所含美國管制成分超過最低門檻的物品(對包括中國在內的大多數國家，通常為25%；對若干受到全面制裁的國家，則為10%)；
- (iii). **國外直接產品**：特定由國外生產的物品，若為特定美國技術或軟件的直接產品，或由本身即為特定美國技術或軟件的直接產品的工廠或工廠主要部件所生產者。

受《出口管理條例》(EAR)管制的物品，會透過出口管制分類編號(「**ECCN**」)在《商業管制清單》(「**CCL**」)中進行分類。每個ECCN均標示該物品適用的管制等級，並指明出口至哪些國家需取得許可證。受《出口管理條例》(EAR)管制但未列入《商業管制清單》(CCL)的物品，被指定為EAR99，通常僅在出口目的地為受禁運國家或受限制的最終用途／最終使用者時，才需取得許可證。

## 業 務

《出口管理條例》(EAR)的重點不僅在於特定產品的聲明最終用途，更在於對相關因素進行全面評估，例如基礎技術水準、製程流程，以及所涉及的製造節點或製程。因此，儘管我們的產品屬民用用途，但由於其具備先進技術水準，仍可能受《出口管理條例》規範。

### 《出口管理條例》(EAR)的最新發展

於2025年1月16日，美國商務部工業與安全局(BIS)發佈暫行最終規則(「1月16日規則」)，針對前端晶圓製造廠及外包半導體封裝與測試(「OSAT」)公司制定額外的盡職調查程序，以規管受此國外直接產品規則管制的先進運算集成電路的出口。1月16日規則修訂ECCN 3A090.a並新增註釋1，建立一項推定：「適用先進邏輯集成電路」(包括採用16/14納米節點或以下製程，或採用非平面電晶體架構的集成電路，不論該等集成電路的應用情景為何)，均歸類為ECCN 3A090.a，且推定為設計或銷售供資料中心使用，除非得以推翻該項推定。因此，因該國外直接產品規則而受《出口管理條例》(EAR)規範且歸類於ECCN 3A090.a的項目，將受到嚴格出口管制，包括出口、再出口或轉移至中國大陸、香港特別行政區及澳門特別行政區在內的地區時，須取得許可證。

1月16日規則提供了三種方法來推翻這一推定，從而使此類先進計算集成電路不受該國外直接產品規則項下《出口管理條例》管轄，且無需獲得美國商務部工業與安全局的相關許可即可出口至中國大陸、香港特別行政區和澳門特別行政區：

- (i). 若下達晶圓製造訂單的芯片設計商為經批准的芯片設計商(即經美國政府審查的芯片設計商名單內的企業)；
- (ii). 若歸類為ECCN 3A090.a之物品將由經批准的外包半導體裝配及測試(OSAT)公司或「前端製造商」，於澳門以外地區或第740部附錄一國家組別D:5所列目的地進行封裝，且該等實體向BIS作出證明，確認總計近似電晶體數量低於若干門檻(例如低於300億個；或若無高頻寬記憶體(HBM)，則2027年完成出貨量低於350億個，2029年及之後低於400億個)；或
- (iii). 如下達晶圓製造訂單的芯片設計商乃符合ECCN 3A090.a註釋1所述標準的獲授權芯片設計商，並須向BIS履行若干申報規定。

### 符合美國出口管制法規

#### 1月16日規則之前的ECCN分類

於往績記錄期間，我們採購了若干受《出口管理條例》管轄的物品(統稱為「採購物品」)，包括：(i)知識產權、(ii)設計軟件與工具，及(iii)從代工廠採購的晶圓。我們的採購物品歸類為ECCN 3D991、3E991和EAR99。

## 業 務

於2023年1月及2026年3月，獲授權IC設計者子公司收到了美國商務部工業與安全局商品分類自動跟蹤系統(CCATS)的分類結果，表示製成品(包括含有採購物品之產品，統稱為「集團產品」)若受《出口管理條例》管轄，則歸類為ECCN 3A991或EAR99。

### *1月16日規則之後的ECCN分類*

於2025年頒佈1月16日規則後，據推定，我們的部分集團產品可能將歸類為ECCN 3A090.a，原因是無論此類集成電路的應用場景如何，該等產品採用了「16/14納米節點」或以下制程，或者使用了非平面電晶體架構。

集團產品已通過向前端製造商提供《出口管理條例》第743.9(b)節所述資料，並使下達晶圓製造訂單的獲授權芯片設計商子公司能夠符合ECCN 3A090.a註釋1項下獲授權芯片設計商的資格，從而推翻了該推定。因此，根據該國外直接產品規則1月16日規則，集團產品不受《出口管理條例》管轄，亦不被歸類為ECCN 3A090.a。

### *出口管制分析*

於往績記錄期間，誠如我們的國際制裁法律顧問所告知，我們的集團產品(包括含有採購物品之產品)不受《出口管理條例》管轄，原因是：(i)集團產品並非源自美國；及(ii)集團產品所含的美國原產成分(包括採購物品)未超過適用的最低門檻值。因此，於往績記錄期間，我們的集團產品無需遵守BIS許可要求。

經計及上述情況以及本集團的合規框架，董事認為，出口管制合規安排一致並將持續符合適用的美國出口管制法規。

### **晶圓廠供應商對出口管制合規安排之知情與認可**

於往績記錄期間，若干晶圓廠完全知悉，根據出口管制合規安排通過Amlogic Holdings下達的訂單定制加工的產品其後會轉移予我們銷售及分銷。倘晶圓廠反對將售予Amlogic Holdings Ltd.的貨物轉移予我們，其可拒絕新訂單或終止供應協議，這將中斷我們獲得晶圓製造服務。然而，基於以下原因，我們評估有關反對之可能性偏低：(i)獲授權芯片設計商子公司的獲授權芯片設計商地位(具有就其自身出口管制責任提供更高的合規確定性)；及(ii)截至最後實際可行日期，晶圓廠已接納獲授權芯片設計商子公司的資格，並繼續處理訂單。

## 業 務

### 如出口管制合規安排被認定為不合規的假設影響

僅作說明用途，如我們未實施出口管制合規安排：

- 我們可能須使用來自知識產權軟件供應商之中國分支機構之可資比較知識產權、設計軟件及工具。截至最後實際可行日期，該等可資比較知識產權、設計軟件及工具均可在中國內地採購；因此，我們相信，若我們有意就中國營運訂立獨立授權安排，我們可購買該等可資比較產品。於不太可能發生的情況下，我們可能需要使用不如當前使用者先進的替代知識產權、軟件和工具。在這種情況下，我們可尋求通過以下等方式減輕影響：迭代測試與驗證，包括生產小批量測試芯片，以在大規模生產前識別並解決設計缺陷；通過有限金屬層變更進行有針對性的硬件修改，而非完全重新設計芯片；及軟件和固件優化，以彌補硬件性能差距，並幫助確保產品仍能達到所需目標。該等措施無法保證產品性能的可複製性，並可能導致競爭優勢受損。即使有關複製可行，該等措施可能增加我們的研發工作，並對我們的盈利能力產生不利影響；及
- 我們可能需要委聘可替代供應商提供芯片封裝、測試與組裝服務。此外，雖然我們計劃繼續與領先的代工廠合作進行晶圓製造服務，但我們可能需要委聘另一家合資格實體向該等代工廠下達晶圓製造訂單。有關替代安排很可能涉及更高成本以及在供應鏈管理中投入更多資源，這兩者均可能對我們的盈利能力產生不利影響。

經諮詢國際制裁法律顧問後，董事認為，我們的出口管制合規安排一直並將持續符合適用的美國出口管制法規。有鑒於此，我們認為需要更換現有主要供應商的可能性極低。然而，如果確實發生此類變更，市場上仍有可替代的知識產權和代工廠服務供應商。更換知識產權或遷移至新的代工廠很可能要求我們：(i) 調配額外的研發人員，根據該替代代工廠工藝平台的工藝設計套件、知識產權、標準單元庫及其他參數，調整和完善我們的芯片設計；及(ii) 重複相關的驗證與測試，從而增加研發資源消耗，並延長產品開發與推出週期。請參閱「風險因素－與我們的行業及業務營運有關的風險－我們面臨與國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施、出口管制及經濟制裁相關的風險，且我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響」。

---

## 業 務

---

### 環境、社會及管治

在當前全球可持續發展趨勢的推動下，我們深刻認識到環境、社會及管治（「ESG」）在企業長期穩健發展中的重要意義。我們致力於在創造經濟價值的同時，積極履行社會責任，並以負責任和合規的方式回應利益相關者的合理期望。上市後，董事會確認，我們將持續關注並嚴格執行上市規則附錄C1《企業管治守則》、附錄C2《環境、社會及管治報告守則》，同時全面遵守所有與ESG相關的規則與條例。此外，我們將每年披露公司的重大ESG事宜、風險管理、目標的完成情況及表現。我們相信，良好的ESG實踐不僅有助於提升企業競爭力，也能為社會的可持續發展作出積極貢獻。

### ESG管治架構

我們高度重視對ESG事務的整體管治。董事會在ESG方面承擔最終監督角色，並關注公司在長期戰略中面臨的相關風險與機遇。公司管理層將配合董事會的指引，推動ESG相關工作的逐步落實，並在日常經營中持續融入合規及風險管理理念，從而形成自上而下的管治機制。通過這種安排，我們期望在企業發展過程中兼顧經濟效益與社會價值，建立穩健而長遠的管理基礎。

在內部管治方面，我們已制定若干政策，涵蓋公司管治、合規管理、商業道德及數據與信息安全等方面。這些政策為我們的運營提供制度保障，並通過完善的管理機制推動誠信與風險意識的普及，確保我們在快速發展的過程中始終遵循穩健、合規的原則。

從社會角度來看，我們注重與利益相關者保持良性互動，持續提升研發與質量管理能力，並在供應鏈管理中貫徹合規與責任理念，以維護合作關係的長期穩定。同時，我們關注員工的職業發展與福祉，重視建立公平、積極進取的企業文化，從而為公司可持續發展奠定堅實的人才基礎。

從環境角度來看，我們於在日常運營中積極踐行綠色低碳理念。儘管我們專注於設計研發而不涉及生產製造，但我們通過倡導節能、資源高效利用及綠色辦公等方式，提高環保意識，並將可持續發展逐步融入業務運作之中，以支持全球應對氣候變化和環境保護的努力。

---

## 業 務

---

我們堅信，穩健的ESG管治不僅是公司合規運營的重要基礎，更是實現長期可持續發展的關鍵保障。通過持續完善管治架構、強化風險管理和推動社會及環境責任，我們期望在滿足監管要求的同時，為客戶、合作夥伴、員工及社會創造持久價值，並在全球可持續發展的進程中發揮積極作用。

### ESG風險管理及策略

我們高度重視ESG議題的識別和管理。隨著全球可持續發展趨勢的不斷深化，以及監管環境和市場期望的逐步提升，我們認識到ESG因素可能對業務模式、價值鏈和財務表現產生重要影響。因此，我們將ESG相關風險的識別和管理視為一項持續性的過程，力求在業務發展和風險控制之間實現平衡。

在風險識別和評估方面，我們結合國家及地方的政策導向和行業發展趨勢，對公司經營活動及價值鏈進行梳理，逐步識別出可能對公司產生影響的環境、社會及管治議題。同時，我們通過日常管理和溝通機制，收集來自客戶、員工、供應商及其他利益相關方的反饋，並對相關議題的重要性進行評估。通過這一過程，我們能夠逐步建立ESG議題的優先順序，合理分配管理資源，並在重大議題上加大關注和投入。我們的過往ESG合規成本主要是員工工傷保險投入，於2025年，ESG合規成本為人民幣2,061,000元。

以下列出我們識別出的若干重要風險，以及我們針對這些風險所採取的緩解措施：

重要風險	潛在影響	應對策略
創新與研發.....	半導體行業技術迭代快、市場競爭激烈，若研發投入不足或創新能力不足，可能導致公司在競爭中失去優勢。	我們保持高強度研發投入，推出多款新產品，取得顯著市場突破。同時，我們通過設立專利獎金和研發項目獎金，激勵研發團隊創新，促進研發成果轉化。

## 業 務

重要風險	潛在影響	應對策略
客戶權利保障...	客戶滿意度直接關係到公司的聲譽與持續發展。若未能有效保障客戶權益，可能導致客戶流失、聲譽受損，甚至引發法律或監管責任。	我們已建立客戶反饋與投訴處理機制，對問題處理流程、解決時間和責任歸因作出明確要求，確保客戶的合理訴求能夠得到及時而有效的回應。
產品質量管理...	產品質量直接關係到公司的核心競爭力和客戶信任度。若質量控制不嚴，可能帶來市場信譽受損、客戶流失及法律責任等潛在風險。	我們始終將質量視為發展的核心，已通過ISO9001質量體系認證，並在芯片設計中實施嚴格的驗證與測試，確保性能與穩定性。同時，針對上游供應鏈以及下游客戶進行全價值鏈管理，保證從芯片設計到生產交付的全流程質量可控。
信息與隱私安全 .....	隨著數字化程度不斷提高，信息洩露、數據濫用或系統攻擊等風險可能對公司業務和客戶信任帶來嚴重影響。	我們建立專業的安全團隊，全面開展信息安全防護工作，定期進行網站漏洞修復、客戶端安全補丁升級、操作系統升級及防病毒軟件檢查，確保系統持續安全運行。同時，我們特別設立「數據所有者」角色，負責確保其部門或區域內的員工接受充分培訓並嚴格執行政策要求。

---

## 業 務

---

### 環境

#### 環境保護

在全球可持續發展趨勢的推動下，我們深刻認識到環境保護對企業長期穩健發展的重要意義。作為一家Fabless模式的公司，我們雖然在日常運營中並不直接涉及生產製造環節亦不直接對環境產生污染，但我們積極倡導綠色低碳的發展理念。

在策略上，我們專注於芯片研發過程中的綠色創新，在設計與研發過程中，注重減少資源消耗，優化電路設計，提高產品的能效和性能，推動低功耗、高效能的芯片解決方案。通過技術創新，推動更綠色的集成電路產品上市，減少產品生命週期中的環境影響。

在風險管理方面，我們認識到環境風險可能對企業運營和員工安全產生一定影響。我們已針對火災、自然災害等突發事件制定預防和應對措施，以降低潛在不確定因素帶來的風險。我們也將持續關注相關法律法規和行業趨勢，確保公司在環境事務上的管理保持合規和穩健。

#### 氣候變化及應對

我們高度關注全球氣候變化問題，並將相關理念融入日常經營管理理念。我們在運營過程中不直接產生大量溫室氣體排放。公司的主要溫室氣體排放來源為汽車燃油消耗所產生的能源直接排放（範圍1）以及外購電力產生的能源間接排放（範圍2）。對於溫室氣體（範圍3）排放，現階段我們正致力於識別價值鏈中的排放源，並計劃與核心供應商初步建立碳數據溝通機制。我們適時將範圍3排放的核算與管理工作納入整體規劃。

在策略上，我們採取主動性措施以減少溫室氣體排放，優先使用新能源車輛以降低傳統燃油車的使用，並引入車輛管理系統優化運營效率。公司積極推動可再生能源的應用，在辦公樓屋頂建設光伏發電系統，並將光伏發電接入公司電網，以優先使用清潔能源、減少對傳統電力的依賴。同時，我們對現有建築進行了綠色改造，包括增加保溫層和使用節能玻璃，以降低建築能耗。

## 業 務

在風險管理方面，我們注重在企業運營管理中納入氣候變化因素，並在可控範圍內應對潛在環境風險，確保公司在發展業務的同時兼顧對環境的責任。

指標與目標：2025年度，我們堅持綠色低碳運營，公司光伏累計發電量為96.25兆瓦時。下表列舉了公司碳排放數據。在披露碳排放強度的半導體企業中，我們的碳排放強度顯著低於行業平均水平0.1928 tCO<sub>2</sub>e／萬元營收。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
溫室氣體排放範圍一(tCO <sub>2</sub> e) . . . . .	13.18	38.60	23.72
溫室氣體排放範圍二(tCO <sub>2</sub> e) . . . . .	1,733.14	2,095.43	1,931.16
溫室氣體排放總量(範圍一+範圍二) (tCO <sub>2</sub> e) . . . . .	1,746.32	2,134.03	1,954.88
溫室氣體排放強度(tCO <sub>2</sub> e／萬元 營收) . . . . .	0.0033	0.0036	0.0029

### 資源使用

在日常生產經營過程中，我們的資源使用主要來自辦公用電、生活用水及辦公用品的消耗。公司秉持可持續發展的原則，積極推動精細化管理，努力提高能源和水資源的利用效率，降低不必要的消耗。

在策略上，我們制定了《環境管理辦法》和《能源管理辦法》，並通過日常監督和管理推動制度落實。為節約用電，我們推廣節能設備的使用，如節能燈具、節能空調等，並採用自動化控制系統優化能源使用。為節約用水，我們安裝節水型設備，如節水龍頭、節水馬桶等，同時倡導節水理念，引導員工養成良好用水習慣，將環保理念轉化為日常自覺行動，實現水資源的高效利用。公司還推行無紙化辦公、雙面打印、採購環保辦公用品以及鼓勵員工自備水杯等措施，進一步推動資源節約和循環利用。

## 業 務

在風險管理方面，我們通過日常監督和定期檢查，確保能源、水資源及辦公用品的使用保持在合理和可控範圍內。通過對設備、水管及辦公資源的定期檢查和維護，公司能夠及時發現和處理潛在問題，從而持續優化資源使用效率。

指標和目標：2025年，由於業務擴張，公司用水量較上一年略有增加，但我們將持續關注資源使用情況，優化管理措施，推動資源的高效利用，確保資源使用與公司可持續發展目標保持一致。在披露用水量的半導體企業中，我們的用水量顯著低於行業平均水平3.0212 t／萬元營收，主要因公司以芯片設計為主，生產環節少，用水需求低。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
用電量(兆瓦時).....	3,229.85	3,905.01	3,598.89
用電強度(兆瓦時／萬元營收).....	0.0060	0.0066	0.0053
用水量(噸).....	6,721	6,866	10,118
用水量(噸／萬元營收).....	0.0125	0.0116	0.0149

### 廢棄物管理

鑒於我們的業務性質，日常運營活動不涉及生產型廢水、廢氣和危險廢棄物的排放。公司在日常辦公過程中僅產生少量生活污水，並已接入市政管網統一處理，從而確保日常運營符合當地法律法規要求。

在策略上，我們針對辦公和研發過程中產生的廢棄物，在《環境管理辦法》中制定了相應管理條例。公司辦公活動中產生的廢棄物主要為紙張、塑料等可回收物。我們在辦公區域設有專門的垃圾分類收集設施，對廢棄包裝材料、電子設備、辦公紙張和生活垃圾等實施分類處理，以提高資源回收利用率。同時，公司提倡優先選用可循環環保材料，從源頭減少廢棄物的產生，努力降低對環境的潛在負面影響。

## 業 務

在風險管理方面，我們通過日常監督和分類管理，確保辦公廢棄物得到妥善處理，減少因管理不當可能帶來的合規風險和環境風險。通過持續改進內部管理，公司力求保持廢棄物處理的規範性與有效性。

### 社會

#### 僱傭

我們在招聘過程中嚴格遵守運營所在地的勞工管理相關法律法規的要求，秉承合規、公正和透明的原則，確保員工權益得到充分保障。

策略上，我們制定《員工手冊》，以公平、公正、公開的招聘原則，吸引來自不同背景的人才，保障每位員工在公司中的平等機會與尊嚴。在薪酬福利方面，我們實施《薪酬福利管理制度》《績效管理原則》，同時開展中長期員工激勵。我們充分傾聽員工需求和意見，通過職工代表大會、員工滿意度調查等措施，不斷優化和完善福利體系、績效管理體系等，以更好地滿足員工的多樣化需求。

風險管理方面，我們制定《禁止使用童工規定》《反歧視反騷擾政策》等政策規範，杜絕任何形式的童工、強迫勞動、歧視、騷擾等行為，營造包容和尊重的工作環境。

指標與目標：截至2025年12月31日，我們共有1,945名員工，下表按性別、年齡組別和學歷劃分員工數目。員工流失率為5.12%，低於半導體行業平均水平10.83%，體現了我們在員工保留和穩定性方面的良好表現。

	員工人數 (人)	佔員工總數 的百分比 (%)
按性別劃分		
男性 .....	1,540	79.2
女性 .....	405	20.8

## 業 務

	員工人數 (人)	佔員工總數 的百分比 (%)
按年齡組別劃分		
30歲以下員工人數 .....	444	22.8
30-50歲員工人數 .....	1,453	74.7
50歲以上員工人數 .....	48	2.5
按學歷劃分		
本科以下員工人數 .....	108	5.6
本科員工人數 .....	966	49.7
碩士員工人數 .....	856	44.0
博士員工人數 .....	15	0.8

### 健康與安全

我們確立了「安全為基、預防為先、責任共擔」的管理方針，以及「零重大安全事故」的長期目標，致力於為員工創造安全、健康的工作環境。

策略上，為實現上述方針和目標，我們制定《職業健康管理制度》，通過定期體檢、應急演練、設備升級和技術創新，不斷提升安全管理水平，保障員工健康安全。

風險管理方面，我們全面識別和管控生產過程中的安全風險與職業健康隱患，定期採購並配備口罩、創可貼等防護用品，及時發現並解決潛在安全隱患。

指標與目標：2025年度，我們的因工受傷或死亡人數為0，因工傷損失的工作日數為0天，表現優於行業平均水平，顯示我們在職業健康與安全管理方面維持良好水平。

### 發展及培訓

我們秉持以人為本的理念，持續完善培訓與發展體系，通過多層次、全方位的培訓機制，推動員工能力與組織成長深度融合。

策略上，我們制定《培訓管理制度》，針對不同階段員工提供分層分類的培訓項目，助力員工快速融入、專業成長與職業發展。

---

## 業 務

---

指標與目標：2025年度，員工培訓總時長達17,934小時，員工平均受訓時數約9.2小時，在披露員工平均受訓時數的半導體企業中，我們的表現與行業平均水平基本一致。

### 供應鏈管理

我們特別強調供應商在ESG方面的表現，建立了嚴格的供應商管理體系，以期推動供應鏈上下游共同實現綠色可持續發展。

策略上，我們制定《供應商開發認證及導入指導規範》等制度文件，規範對供應商開發、認證、導入的管理，保障供應商資源滿足我們的發展需求，以維護供應鏈的可持續性和穩定性。我們將供應商的考核和管理視為保障供應鏈質量和效率的關鍵環節，通過制定《外包商管理程序》，明確供應商的考核方式、考核標準和退出機制，持續監督供應商的表現。此外，我們不定期組織多樣化的培訓課程，幫助供應商提升專業能力，共同實現高質量發展。

風險管理方面，為降低供應鏈風險，保障供應鏈安全，我們與供應商簽署包括但不限於反歧視及反騷擾、禁止強迫勞動、禁止使用童工、健康與安全標準、環境保護、反腐敗與反賄賂措施、利益衝突管理、負責任的礦產採購、個人信息和隱私保護、知識產權尊重、貿易合規性等方面的承諾書，並適時對供應商員工和代表進行培訓，確保他們充分理解與其職責相關的行為準則。

### 信息安全與隱私保護

我們高度重視信息安全管理。請參閱「— 信息安全及數據隱私」。

### 反貪污

我們嚴格遵守運營所在地的反貪污法律法規，建立了反舞弊組織架構，明確各層級人員在反舞弊工作中的職責權限。董事會負責協調、指導和監督反舞弊工作，管理層將反舞弊工作納入日常管理，並提供必要的資源支持，內審部門作為反舞弊工作的日常工作部門，負責執行年度審計計劃中的舞弊風險評估，確保反舞弊工作能夠從戰略層面到執行層面得到全面覆蓋。

---

## 業 務

---

策略上，我們制定《反商業腐敗及商業賄賂承諾協議》和《反腐敗及反賄賂合規政策》等規定，規範商業道德行為。這包括和員工簽署廉潔承諾書，開展專題培訓，提升員工的合規意識；要求供應商簽署《供應商道德與合規承諾》，從供應鏈源頭做好廉潔管控；以及和客戶簽署《反腐敗反賄賂承諾書》，確保合作的透明度。

風險管理方面，我們不斷優化舉報工作流程，接受實名或匿名舉報，並要求所有員工配合事件的調查和取證工作。對於重大舞弊事件，內部審計部將向審計委員會匯報舉報和調查處理結果，並及時立卷歸檔，以便董事會檢查。同時，我們嚴格保密舉報人相關信息，確保舉報人的正當權利得到保障。

指標與目標：2025年度，我們開展2次反腐敗培訓，覆蓋全體員工，未涉及有關貪污、賄賂或欺詐的任何法律訴訟。

### 內部控制及風險管理

我們已建立並維持健全的風險管理與內部控制系統，涵蓋財務報告、合規、信息安全及人力資源管理。我們的董事會及高級管理層負責內部控制系統的建立與定期更新。

#### 財務報告風險管理

我們已採用涵蓋財務管理、預算管理及財務報表編製的全面會計政策，由我們的財務部門定期審閱管理賬目。我們持續為財務人員提供培訓，以確保該等政策有效執行。

#### 信息系統風險管理

我們已實施嚴格的內部程序及控制措施以防止數據洩漏及遺失，旨在防止未經授權的存取，並確保敏感信息的安全。

#### 合規與知識產權風險管理

我們已實施嚴格的內部程序，以確保符合相關法律法規，並保護知識產權，包括及時獲得政府預先核准以及維護商標、著作權及專利的註冊。

---

## 業 務

---

### 人力資源內部控制

我們已就人力資源管理制定全面的內部控制政策，涵蓋招聘、培訓、工作道德及法律合規。我們定期進行績效評估，並將薪酬與績效結果掛鉤。我們密切監控內部風險管理政策的執行。

### 關稅及出口管制風險管理

近年來，國際關係錯綜複雜，例如中美之間的地緣政治緊張，帶來了新的挑戰及持續的不確定性。請參閱「風險因素－與我們的行業及業務營運有關的風險－我們面臨與國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施、出口管制及經濟制裁相關的風險，且我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響」。

截至最後實際可行日期，我們不直接向美國出口產品，故我們的產品不受任何現有或擬訂關稅約束。於往績記錄期間，我們並未直接向美國市場出口製成品，而我們從美國的採購主要來自Amlogic USA的研發及配套服務，這些服務不受任何現行或擬議關稅的影響。基於物流、商務慣例及外匯結算等考量，我們的客戶通常選擇香港作為交貨地點。

董事認為（聯席保薦人亦同意），鑒於在往績記錄期間及截至最後實際可行日期：  
(i) 我們並無直接向美國市場出口製成品；(ii) 我們採購自美國之服務未受關稅影響；及  
(iii) 我們未因美國或其他海外關稅措施而遭遇銷售額、訂單量、銷售價格或財務表現之重大不利變動，亦未接獲客戶要求取消訂單或重新協商銷售條款之重大請求，近期美國關稅政策的發展，對本集團並未造成亦預期不會造成重大不利影響。

我們相信，對我們業務的任何潛在關稅影響均為間接影響且可控。儘管我們目前不存在直接關稅風險，但我們已考慮有關涉及對銷往美國市場的產品恢復歷史高關稅水平的最壞情況。即便在該情形下，我們的產品將不會直接面臨關稅影響，因為我們不直接向美國客戶銷售產品，且交付均通過香港進行架構安排。然而，對客戶終端產品加徵的關稅可能對客戶需求及定價造成負面影響。為減輕該等潛在間接影響，我們計劃持續積極拓展客戶群，並與多個司法管轄區的晶圓代工廠及封裝測試服務供應商保持緊密合作關係。此策略旨在確保供應連續性，並降低未來關稅變動可能造成的財務衝擊。